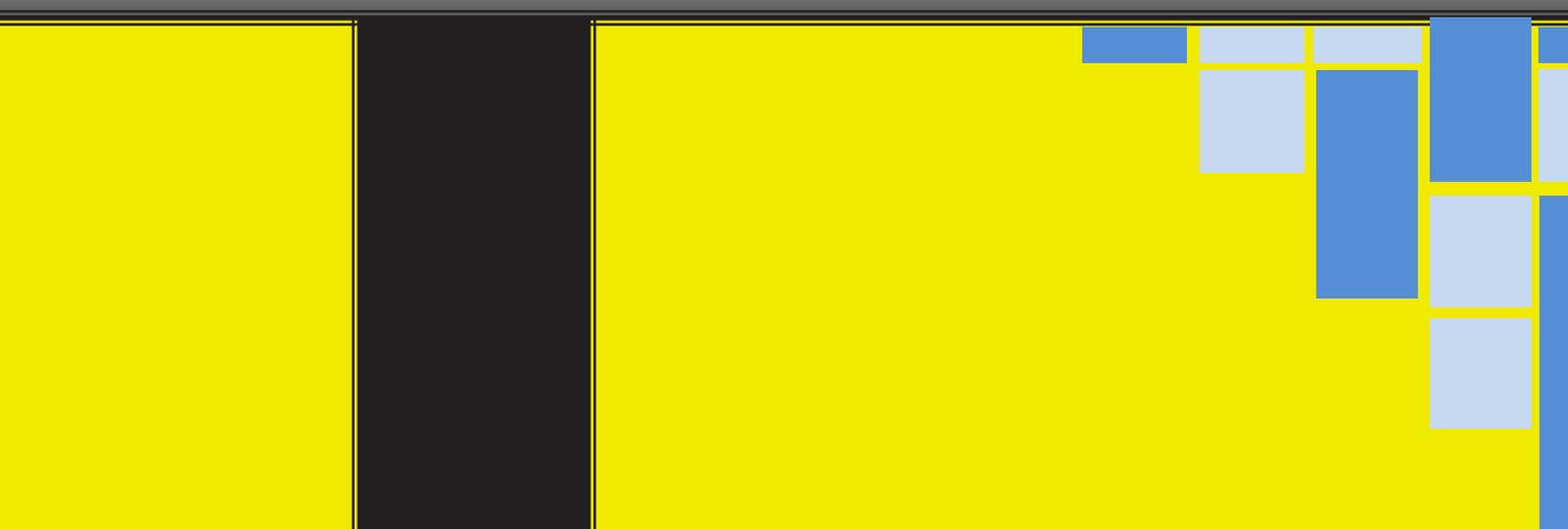


令和4年度
事業概要報告書

京都府中小企業技術センター

<https://www.kptc.jp/>



目 次

当センターの概要	
1 所在地及び施設等	1
2 組織図	2
3 人員構成	2
4 令和4年度の利用状況等の概要	3
I 中期事業計画の重点取組の推進	
1 重点目標	4
2 取り組みのコンセプト	4
3 取り組みの内容	4
II 技術支援	
1 技術相談	5
2 依頼試験	8
3 機器貸付	11
4 企業訪問による現地現場対応(中小企業技術応援隊)	12
5 企業への助成・表彰等に係る技術審査	12
6 府施策と連携した技術的対応	12
7 地域技術相談会の開催(中小企業技術応援隊)	13
8 出張技術相談会の開催(中小企業技術応援隊)	13
III 人材育成	
1 研究会、セミナー・講習会の開催	14
2 研究生・実習生の受け入れ	17
3 中小企業への啓発等	18
IV 研究開発	
1 所内研究、共同研究	20
2 受託研究	21
3 委託研究	21
4 研究課題評価	22
5 知的財産の活用	22
6 企業との協働による具体的な技術開発の推進	23
7 研究発表・出講	24
V 関係機関との連携	
1 広域での公設試験研究機関の連携	25
2 産業支援機関との連携	25
3 大学との連携	25
4 業界団体等との連携	25

VI	情報発信	
1	中小企業等への情報提供の強化と、広く府民の皆さんへの広報	26
2	施設の公開	26
3	ニーズの変化に対応した情報の提供	27
VII	地域産業の活性化	
1	北部地域ものづくり産業振興	28
2	けいはんな地域における大学・研究機関と企業との連携推進	29
VIII	技術支援体制の充実・強化	
1	技術職員の資質向上	30
2	機器利用者への支援体制強化	30
3	知的財産の管理	30
4	機器の整備	30
5	業務運営に係る基盤的事項	32
	(参考)	
	審査会等への出席一覧	33
	研究会、セミナー・講習会等実績	36
	依頼試験手数料、機械器具貸付料の特例措置について	40
	依頼試験の項目一覧	41
	機器一覧	45
	館内案内	60
	沿革	61

当センターの概要

1 所在地及び施設等

(1) 本所

- 所在地 京都府京都市下京区中堂寺南町 134
(七本松通五条下ル 京都リサーチパーク内)
- 土地 1,380 m²
- 建物 7,296 m² (延床面積) (平成元年8月竣工、平成13年12月増築)
 - ・本館 6,175 m² 鉄骨・鉄筋コンクリート造 地上5階、地下1階 (2階を除く)
 - ・研究交流棟 1,121 m² 鉄骨・鉄筋コンクリート造 2階建のうちの1階部分
- 設備・機器 約200機種 (100万円以上の機器)

(2) 中丹技術支援室

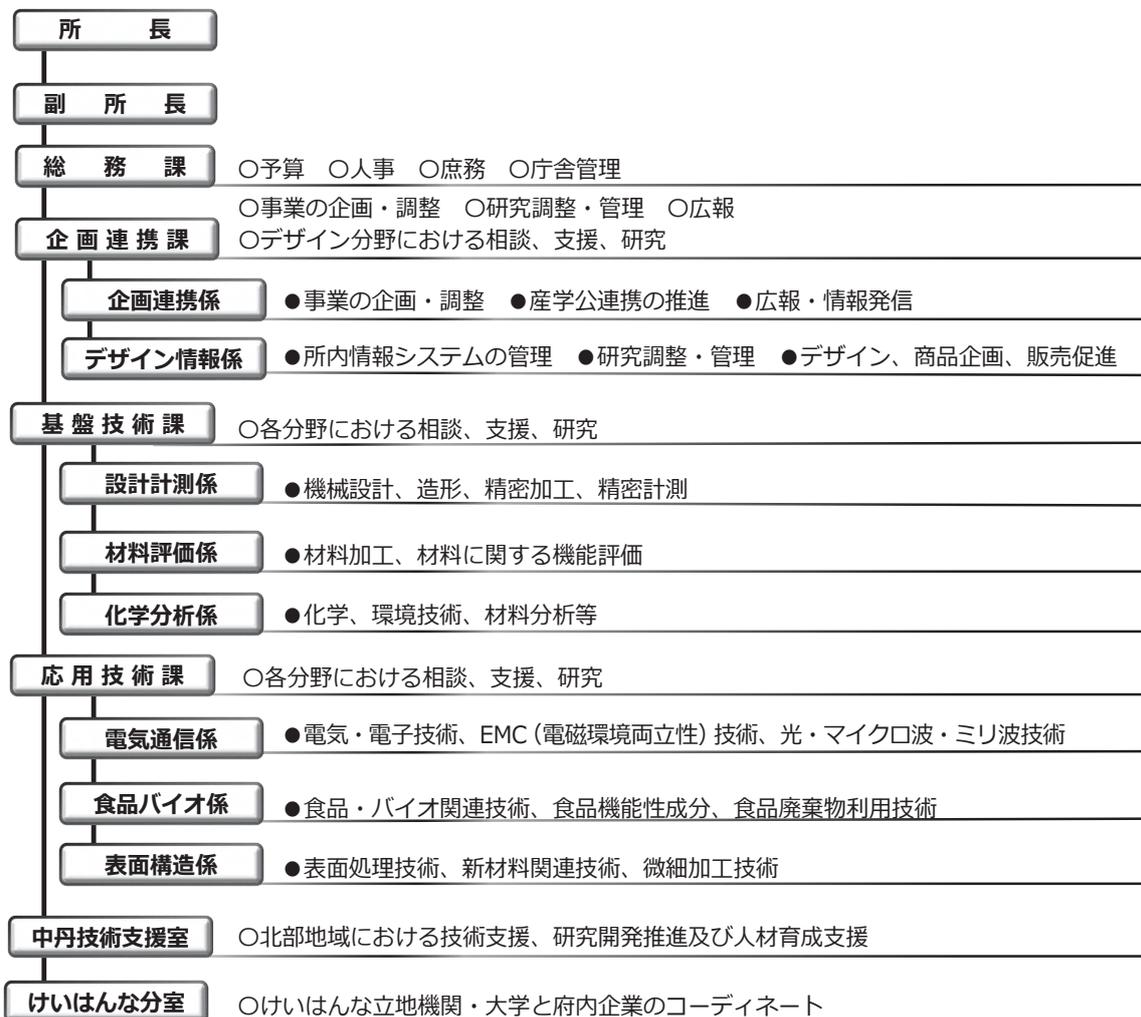
- 所在地 京都府綾部市青野町西馬場下33-1
(北部産業創造センター内)
- 建物 1,472m² (鉄骨造 2階建)
- 設備・機器 約100機種

(3) けいはんな分室

- 所在地 京都府木津川市木津川台9丁目6 / 相楽郡精華町精華台7丁目5
関西文化学術研究都市 (京都府精華・西木津地区)
(けいはんなオープンイノベーションセンター (KICK) 内)

(令和5年3月31日現在)

2 組織図



3 人員構成

	人 数	人 数		
		事 務	技 術	技能労務
所 長	1		1	
副 所 長	1	1		
総 務 課	6	5		1
企画連携課	10	2	8	
基盤技術課	9		9	
応用技術課	12		12	
中丹技術支援室	4(1)	(1)	4	
けいはんな分室	1	1		
計	44(1)	9(1)	34	1

注：() は市町村実務研修生で外数。会計任用職員を除く。

(令和 5 年 3 月 31 日現在)

4 令和4年度の利用状況等の概要

(1) 数値目標と実績

	項 目	目 標	実 績	達成率
技術支援	◇技術相談・指導件数	2,000 件	1,784 件	89%
	◇機器貸付件数	3,100 件	2,795 件	90%
	◇依頼試験(種目)件数	1,450 件	1,305 件	90%
	◇企業訪問件数	450 社	384 社	85%
人材育成	◇研究会・セミナー開催回数	195 回	228 回	117%
	◇研究会・セミナー参加人数 ^(注1)	5,000 人	5,037 人	101%
研究開発	◇研究調査(所内・共同・受託)件数 ^(注2)	15 件	12 件	80%
情報発信	◇ホームページ閲覧件数	(注3) 280,000PV	268,576PV	96%
中期計画	◇外部資金獲得申請件数	4 件	0 件	0%

(注1) Web 参加・視聴を含む。 (注2) 研究芽出し(課題解決)を含む。

(注3) PV(ページビュー) : ページが開かれた回数。

(2) その他実績

	内 容	実 績	備 考
技術支援	ハイテク技術巡回指導	3 件	特別技術指導員等による指導
人材育成	研究生等の受け入れ・延べ人数	173 人	
研究開発	委託研究	1 件	委託先 : 京都工芸繊維大学
情報発信	情報誌「クリエイティブ京都M&T」	6,000 部×4 回	四半期毎

I 中期事業計画の重点取組の推進

当センターが「頼られるセンター」であることを目指し策定した「第4期中期事業計画」(事業期間:令和3年度～令和5年度)において3つの重点目標を達成するため事業を推進した。

1.重点目標

(1) 職員力の向上

「頼られるセンター」であるための至上命題。技術継承・資質向上、研究活動の促進、課や係の枠を超えた企業支援の強化などを含めた総合的な職員力を向上させます。

(2) 現場主義の徹底

企業や業界のニーズに対応するために不可欠で、職員力の向上にもつながる重要な命題。企業訪問の促進、業界団体や関係機関等との連携強化など、現場主義を徹底します。

(3) 即応性の強化

社会情勢や環境の変化、災害等の突発的な課題に対応するために必要な命題。状況に即して迅速かつ柔軟に対応できる組織となるため、即応性を強化します。

2.取り組みのコンセプト

「待ちの組織から導ける組織へ ～企業ニーズに即したソリューションを提供します～」

3.取り組みの内容

企業や業界の直面する技術課題やセンターに求められているものを調査等により把握し、どのような解決策を提供できるかを軸に分析を行い、導かれた解決策を事業立案・推進を経て、業務へ反映させることにより、企業や業界への支援を行う業務サイクルを確立することを目指す。

また、「課題発見・分析、事業立案・推進」のサイクルを職員の実践を通して定着、向上させることによって、突発的な課題に対しても迅速かつ柔軟に対応できる組織としての即応性の強化を図る。

令和4年度は事業を推進するため令和3年度に立ち上げた4つの第4期中期事業計画推進プロジェクトチームにより、引き続き具体的な事業推進に取り組んだ。

II 技術支援

急速な産業構造変化の中で、中小企業が自らの「強み」を再認識し、これを活かして力強く活動できるよう、自社だけでは対応が困難な技術開発等に関する支援を行うとともに、各種固有技術の相談や技術的裏付けを取る依頼試験、機器貸付による開発支援を行った。

1 技術相談

(1) 一般技術相談

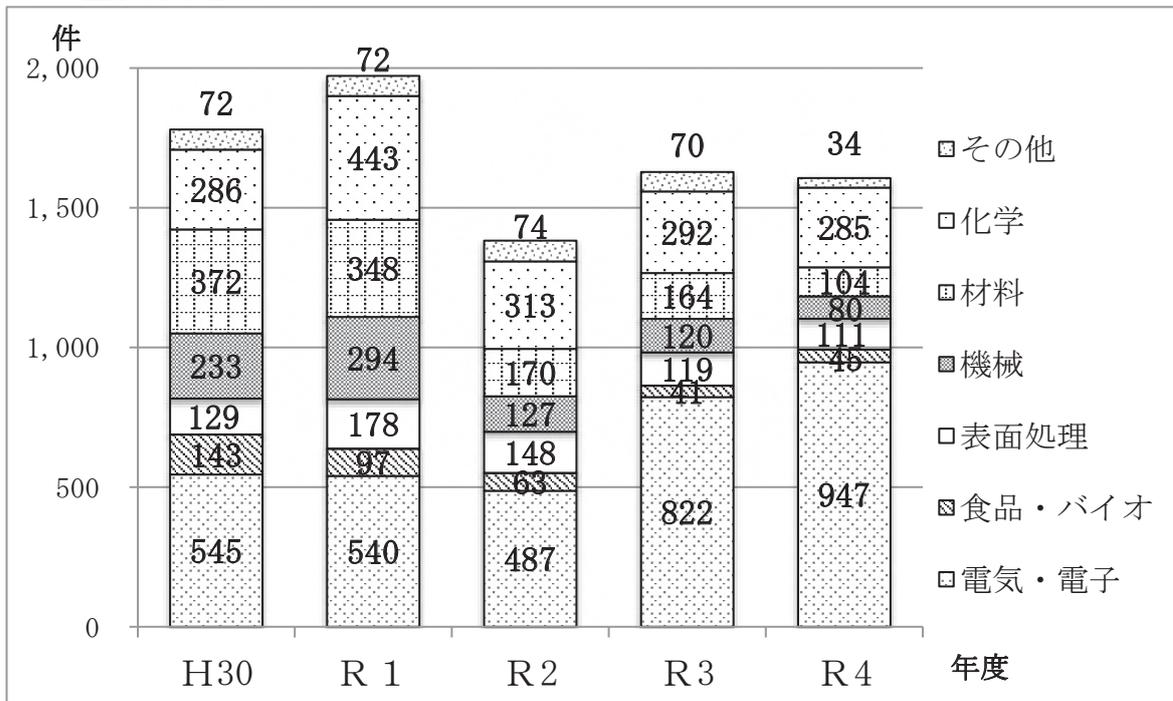
製品開発、品質管理、基礎的技術、実験手法等、中小企業が抱える技術に関する様々な悩みや課題について、当センター職員によるアドバイス及び情報提供等を行った。

令和4年度の技術相談・指導件数、分野別主要技術相談件数は、表1、2及び図1のとおりである。

表1 技術相談件数

内 容	実 績	
技術相談・指導	1,784件	
うち主要技術相談	1,606件	分析、試験、測定、評価 ほか
うち簡易技術相談	178件	

図1 主要技術相談件数



注:簡易技術相談及びハイテク技術巡回指導を除く。

表2 分野別主要技術相談件数

分野 \ 年度	H30	R1	R2	R3	R4
電気・電子	545	540	487	822	947
食品・バイオ	143	97	63	41	45
表面処理	129	178	148	119	111
機械	233	294	127	120	80
材料	372	348	170	164	104
環境	17	2	4	6	1
化学	286	443	313	292	285
情報システム	0	4	0	2	0
デザイン	20	31	54	57	22
その他	35	35	16	5	11
総計	1,780	1,972	1,382	1,628	1,606

(2) 現地技術相談（中小企業技術応援隊）

中小企業の新製品開発、品質管理、技術改善、研究開発等の技術課題について、当センター職員（中小企業技術応援隊）が現地に赴き、アドバイスをを行った。

現地技術相談件数	11件
----------	-----

(3) インターネットによる技術相談

中小企業の多様化する諸問題に迅速かつ的確に対応するため、メールでの相談を受け付け、対応した。

(4) 外部専門家等と当センター職員による指導（ハイテク技術巡回指導事業）

中小企業が創造的・先駆的な技術開発や製品開発等に取り組む中で起こる様々な技術的課題を解決するために、京都府中小企業特別技術指導員（表3）や大学教授等の専門家とセンター職員により、助言・指導を行った。

特別技術指導員等による指導	3件
---------------	----

表3 京都府中小企業特別技術指導員（32名）一覧

（順不同、敬称略、所属は依頼時）

No.	専門分野	氏名	所属
1	応用光学、光工学	粟辻 安浩	京都工芸繊維大学大学院 電気電子工学系 教授
2	電気・電子(実装技術)	河合 一男	実装技研 実装技術アドバイザー
3	品質工学、製品開発(車載関係)	中出 義幸	Nakade メソッド研究所 代表
4	電子制御	牧野 勲	元 日東精工株式会社 開発研究所開発二課長
5	レーザー物理工学	山下 幹雄	北海道大学 名誉教授
6	電磁環境適合性(EMC、試験所品質システム(ISO/IEC 17025))	泉 誠一	京都工芸繊維大学 デザイン主導未来工学センター 特任専門職
7	応用微生物学、食品微生物学、微生物工学	麻生 祐司	京都工芸繊維大学大学院 繊維学系 教授
8	食品衛生管理全般	津田 訓範	シーアンドエス(株) シニアスーパーバイザー
9	食品	早川 潔	元 京都府中小企業総合センター 研究開発課長
10	食品科学、栄養科学、食品機能学	後藤 剛	京都大学大学院 農学研究科 准教授
11	化学(光触媒)	安保 正一	大阪府立大学 名誉教授・元理事・副学長
12	電気化学、湿式製錬	邑瀬 邦明	京都大学大学院 工学研究科 教授
13	工業デザイン	楠 勝彦	京都工芸繊維大学大学院 デザイン・建築学系 教授
14	工業デザイン	吉田 治英	元(株)GK京都 顧問
15	触覚、ロボティクス、メカトロニクス	田中 由浩	名古屋工業大学 電気・機械工学教育類 教授
16	高分子材料強度学、工業製品や部品の長もちの科学	西村 寛之	元 京都工芸繊維大学 繊維学系教授
17	高分子化学、ナノ・マイクロ材料科学、電気化学、光化学	彌田 智一	同志社大学 ハリス理化学研究所 教授
18	機械要素	久保 愛三	クボギヤテクノロジーズ 代表、京都大学 名誉教授
19	CAE解析(開発支援)	田村 隆徳	田村技術士事務所
20	機械設計(3次元CAD)	筒井 真作	キャディック(株) 代表取締役
21	機械加工	松原 厚	京都大学大学院 工学研究科 教授
22	塑性加工学、機械材料加工学	会田 哲夫	富山大学大学院 理工学研究部 教授
23	機械設計、機械加工	川勝 邦夫	舞鶴工業高等専門学校 名誉教授
24	機械設計一般	四方 修	元 日東精工(株) 開発研究所長
25	機械材料学・材料強度学・材料力学	森田 辰郎	京都工芸繊維大学大学院 機械工学系 教授
26	金属材料の腐食防食	藤本 慎司	大阪大学大学院 工学研究科 教授
27	無機材料工学	青井 芳史	龍谷大学 先端理工学部 教授
28	品質工学	芝野 広志	TM実践塾 代表
29	工業分析化学	河合 潤	京都大学大学院 工学研究科 教授
30	生体力学、生体材料、シミュレーション医工学	堤 定美	京都大学 名誉教授、金沢工業大学 客員教授
31	工業所有権	間宮 武雄	間宮特許事務所 所長
32	データサイエンス技術	坂井 公一	(有)坂井経営技術研究所 代表取締役

2 依験試験

中小企業等の技術開発・製品開発の促進や品質向上のため、依頼により材料・部品・製品等を預かり、性能や品質、精度等について、中小企業が独自では導入しにくい設備を用いた高精度な測定・試験・分析を実施した。また、試験後は当センター職員が試験結果の説明及び今後の対応や対策を助言する等、幅広い対応をした。

なお、当センターが企業からの依頼により行った試験、分析及び測定は、表4、5、6及び図2のとおりである。

表4 依頼試験件数

年 度	H30	R1	R2	R3	R4
件数合計	1,514 件	1,703 件	1,370 件	1,448 件	1,305 件
手数料収入額 対前年度比	85.8%	112.5%	91.9%	107.3%	98.2%

注：証明書等の件数を除く。

図2 種目別依頼試験実績

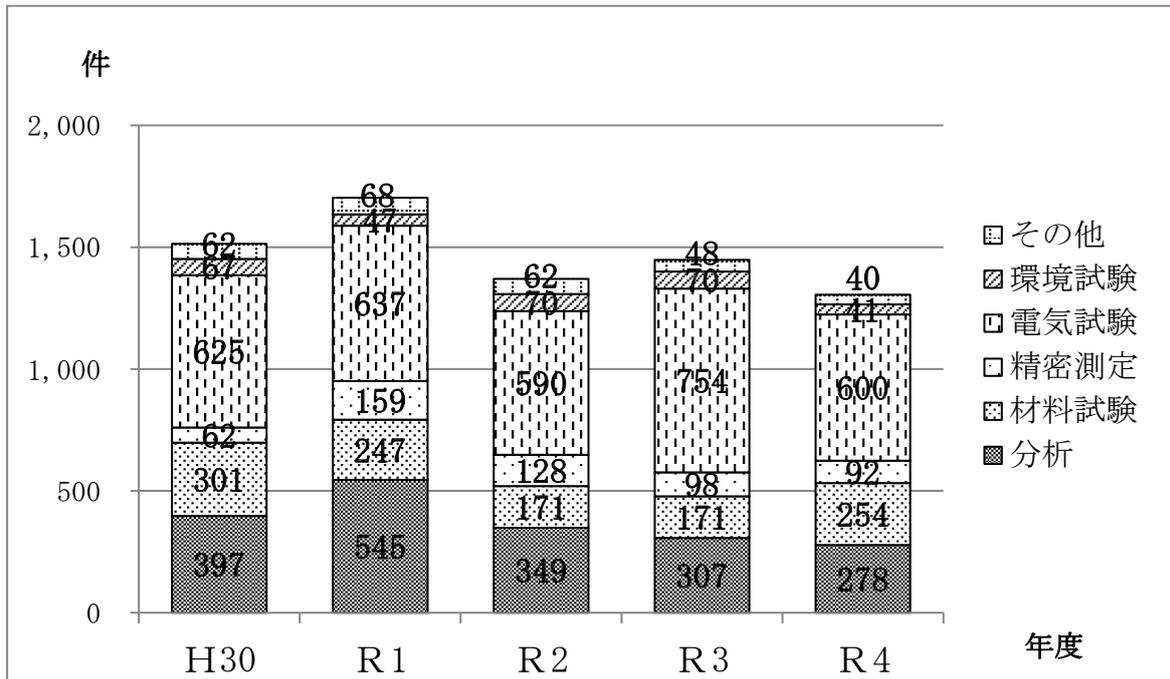


表5 種目別依頼試験件数

項目		年度				
		H30	R1	R2	R3	R4
分 析	化学分析	85	184	56	42	37
	分光分析	112	147	87	68	80
	X線分析	164	171	146	162	120
	表面分析	20	24	15	6	12
	クロマト分析	12	10	27	4	1
	熱分析及びその他の分析	4	9	18	25	28
	小計	397	545	349	307	278
材 料 試 験	強度試験	29	8	25	8	6
	硬さ試験	13	10	14	6	11
	金属組織試験	4	5	7	3	7
	電子顕微鏡試験	123	143	119	92	89
	非破壊試験及びその他の試験	132	81	6	62	141
	小計	301	247	171	171	254
精密測定		62	159	128	98	92
電気試験		625	637	590	754	600
環境試験		67	47	70	70	41
その他の試験及び測定等		62	68	62	48	40
合計		1,514	1,703	1,370	1,448	1,305

表6 実施依頼試験概要

分 析	
化 学 分 析	金属材料等の品質管理及び食品の栄養成分分析が主なものであった。
分 光 分 析	フーリエ変換赤外分光分析による電気・電子部品・プラスチック等の素材解析が多く見られた。 また、ICP 発光分光分析については金属材料のほか、食品及び無機製剤の成分分析等への利用も多かった。
X 線 分 析	蛍光 X 線分析では、品質管理、不具合品の原因究明、研究開発を目的とした金属、セラミックス、有機材料の分析があった。
表 面 分 析	部品の表面変色や微小付着物の成分などの製品不具合の原因調査、ステンレス鋼などの材料表面の品質評価のための分析が多かった。
ク ロ マ ト 分 析	液体クロマトグラフによるアミノ酸分析が主であった。
熱 分 析 そ の 他 分 析	無機材料等の熱特性分析が主なものであった。

材料試験	
強度試験	各種工業材料の強度特性の評価や、溶接部材の強度測定のための利用が多かった。
硬さ試験	金属製部品の品質確認や、材料変更に伴う評価試験が多かった。
金属組織試験	鉄鋼材料の熱処理状態の確認、溶接部の健全性の評価のための試験が多かった。
電子顕微鏡試験	金属部品の破断面解析、表面処理製品の形状観察、微粒子の形状観察、元素分析等に関する依頼が多かった。
非破壊試験 その他の試験	X線透視装置及びX線CT装置を使用した部品内部の欠陥観察が主であった。
精密測定	
寸法測定 形状測定	機械、電気・電子部品(半導体製造装置部品等)は複雑で高精度な形状のものが求められ、CNC三次元座標測定機、曲面微細形状測定システムによる精密形状測定が多かった。
電気試験	
EMC測定	電気・電子機器製品のEMC測定においては、国際規制をはじめとした各種EMC規制に対応するための評価試験が主であった。
電気試験	電気試験においては、電気材料の誘電率、透磁率の周波数特性評価、導電性能の評価が主であった。
光・マイクロ波 ・ミリ波測定	光関連においては、LED照明の評価が主であった。また、マイクロ波・ミリ波関連においては、電磁波シールド・吸収材料、アンテナ特性、高周波デバイスの評価が主で、その多くが新材料・新製品開発に類する分野であった。
環境試験	
温湿度サイクル試験 冷熱衝撃試験	電子機器及び関連部品の他、幅広い分野の利用があった。
腐食試験	機械部品、車載部品等の幅広い分野の材料、製品の塩水噴霧試験による耐食性、耐久性評価の依頼が多かった。
耐候性試験	外壁材、電気製品、革製品、ゴム製品等の幅広い分野の光劣化に関する試験が主であった。
その他の試験及び測定等	
粒子径分布測定	樹脂・セラミックスの他、金属酸化物等の利用があった。
微生物試験	食品の一般生菌数測定が主であった。
食品物性測定	水分活性測定が主であった。
積層造形	筐体や治具等のプラスチック部品の試作での利用が多かった。
膜厚測定	品質管理のためのめっき膜厚測定が主であった。

3 機器貸付

(1) 機器貸付

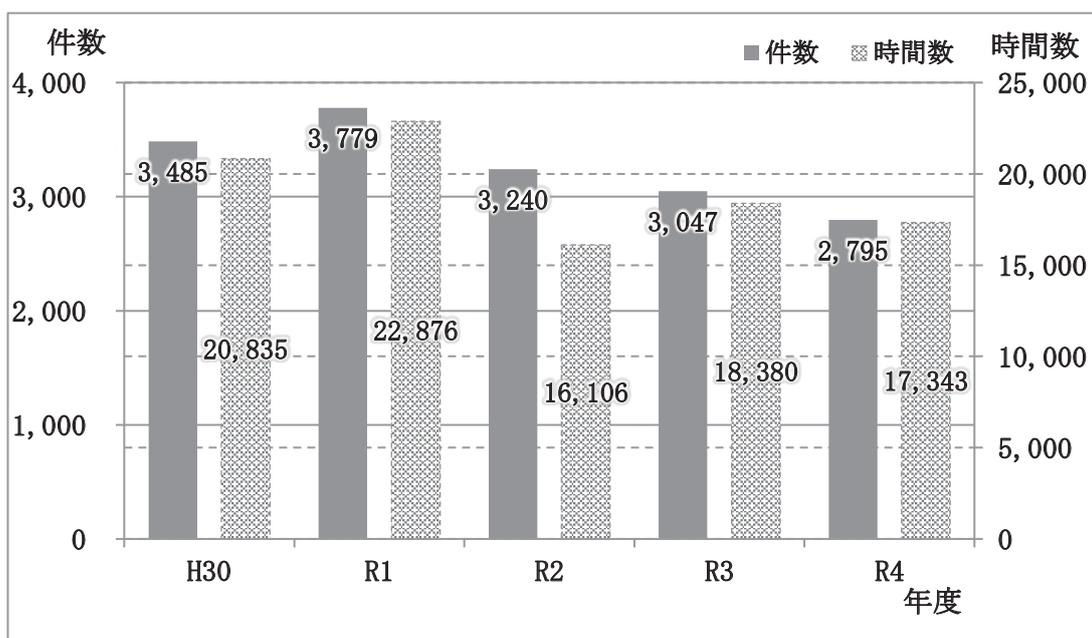
中小企業における技術開発・研究開発・品質改善等を促進し、企業の実験室・研究室としての支援的役割を担うことを目的に、中小企業の方々が自ら操作して試験・評価が行えるように、高度な設備も含めて試験研究用機器を貸し付けた。また、機器利用時には、必要に応じて当センター職員の知識・経験を活かして、的確な支援を行った。

令和4年度は、表7、図3のとおり貸付を行った。利用については、振動試験機(16kN)、分析型走査電子顕微鏡、X線光電子分光分析装置(イオン銃)、フーリエ変換赤外分光光度計(赤外顕微鏡付)、走査電子顕微鏡(JSM-IT-300HR/LA)の利用が多かった。

表7 機器貸付実績

年 度	H30	R1	R2	R3	R4
件数合計	3,485 件	3,779 件	3,240 件	3,047 件	2,795 件
時間数合計	20,835 時間	22,876 時間	16,106 時間	18,380 時間	17,343 時間
貸付料収入額 対前年度比	115.9%	108.2%	74.9%	104.1%	101.7%

図3 機器貸付実績



（２）機器利用実務研修

高度な貸付機器を対象として円滑な利用促進を図るため、要請に応じて機器取扱方法について個別研修を実施した。

個別研修実施人数	713 人
----------	-------

4 企業訪問による現地現場対応（中小企業技術応援隊）

業界や中小企業が抱える技術的課題や取り巻く現状等を把握するとともに技術の強みを掘り起こし、中小企業の技術力強化を支援した。

表 8 中小企業技術応援隊実績一覧

名 称	実 績	
企業訪問	384 社	
京都府中小企業技術センター協力会の活動支援(セミナー等)	2 回	52 名
研究会、セミナー・講習会での技術支援	回 数 :	227 回
	延べ参加者 :	5,029 名 (注)

(注) Web 参加・視聴を含む。

5 企業への助成・表彰等に係る技術審査

(公財)京都産業 21 による技術顕彰「京都中小企業技術大賞」及び「京都府発明者等功労者表彰」における候補企業の推薦や技術内容の調査、ヒアリング等技術面からの支援を行った。

表彰等候補企業調査数	17 件
------------	------

6 府施策と連携した技術的対応

（１）電磁環境両立性（EMC）国際規制対応支援事業

電気・電子機器を国内外で販売するためには、欧州、米国を始め、中国、韓国等、全世界で実施されている EMC 規制基準に適合させる必要がある。そのため、校正(標準化)した計測機器と電波暗室を提供して関連業界が各種規制を効率的にクリアできるように支援した。

(2) デザインワーク展示事業

中小企業等において商品企画やデザインを検討する場合、どのように、どのデザイナーに相談すればいいのか、費用はどれくらいかかるのか等が分からず、活用できていないのが現状である。そこで、デザイナーと企業が出会える場を提供することによって、デザインマッチングを推進するためにデザインワークの展示発表を行った。

表9 デザインワーク展示事業概要

名 称	令和4年度デザインワーク展示事業 KYOTO DESIGN WORK SHOW ーものづくり企業とデザインのマッチングー
日 時	令和5年2月16、17日 10～17時
場 所	京都府総合見本市会館「京都ビジネス交流フェア2023」会場内
出展内容	プロダクトデザイン事務所6社とそのデザインワーク事例
来 場 者	約5,000名

(3) 個別デザイン課題解決のための研究・開発プロジェクトの実施と成果公開

商工業全般にわたる企業や業界、各種団体が抱えている様々なデザイン課題の中からデザイン開発のケーススタディとして適切なものをテーマとして取り上げ、産業デザイン手法を活用した課題の具体的な解決に取り組み、産業デザインの導入・活用の事例としてとりまとめ、広く普及を図ることによりデザインの戦略的な活用を推進した。

7 地域技術相談会の開催（中小企業技術応援隊）

広域振興局、府内市町村、産業支援機関や地域業界団体との積極的な連携により、中小企業への技術支援を行った。

8 出張技術相談会の開催（中小企業技術応援隊）

中信ビジネスフェア2022に当センター独自のブースで出展した。来訪企業及び出店企業ブースを職員が訪問して当センターの企業支援の説明等を行い利用促進と周知を図った。（計45社58名（職員ごとの重複除く））

また、京都ビジネス交流フェア2023に「出張！技術相談会」として京都府ブース内で出展し、23企業から技術相談を受けた。職員も交代で企業ブースを訪問し、24企業との間で近況報告や情報交換を行った。

Ⅲ 人材育成

1 研究会、セミナー・講習会の開催

これまでのセミナー等の参加者アンケートの情報を踏まえ、最新の技術動向・企業ニーズに対応するとともに、研究成果の普及や参加者に有益な研究会、セミナー等を実施した。

※開催回数等は、表12のとおり。

(1) 研究会

① 新工芸研究会 (企画連携課 デザイン情報係)

京都の文化と工芸の歴史的経緯を踏まえながら、現代の新たな技術、素材を取り入れ、伝統工芸を横断的に結んだ新たな京都工芸の創造につなげるため、調査研究や試作開発研究・需要開拓研究等を行った。

② ものづくり分析評価技術研究会 (基盤技術課 材料評価係)

現場で生きる分光分析に関する系統のかつ高度な知識とノウハウを兼ね備えた“ものづくり技術人材の育成”を支援し、ものづくり企業の技術力の向上と製品開発の後押しを図った。

③ 京都光技術研究会 (応用技術課 電気通信係)

幅広い光関連技術分野の業界の動向・ニーズについて情報交換を行い、企業間連携の促進、課題に応じた共同研究の立ち上げ等のマッチングを支援した。

④ 京都実装技術研究会 (応用技術課 電気通信係)

電子機器の生産に深く関わる接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の課題の解決を目的とした、セミナーやワーキング活動を行った。

⑤ 表面処理技術研究会 (応用技術課 表面構造係)

京都府鍍金工業組合青年部と共催し、若手技術者、経営者の技術者向上のため、品質管理、新規市場の開拓について研究紹介や技術講習会を開催した。

⑥ デジタルマニファクチャリング研究会 (中丹技術支援室)

開発プロセス（設計—試作—評価）での CAE の活用を体感できる研究会活動を通じて、中小企業のものづくり現場におけるフロントローディングを後押しした。

⑦ 製品開発企画研究会 (中丹技術支援室)

中丹地域を中心としたものづくり企業の製品開発力を高め、経営資源を強化するために、自社の強みやスキルを活かし、地域産業の育成に貢献できる新製品の開発に必要な基礎知識や開発の進め方を実践的に学ぶ研究会を開催した。

(2) セミナー・講習会等

① 企業情報化支援セミナー (企画連携課 デザイン情報係)

中小企業の情報化を支援するために、関連団体と連携して開催する、情報システムを活用した業務効率化等のための最新技術や動向に関するセミナーを開催した。

② 京都グッドデザイン戦略支援セミナー (企画連携課 デザイン情報係)

デザインの活用を考えているが心配や不安のある経営者の方々を主な対象に、中小企業のデザイン導入事例等を紹介しながら独自の企業価値を高める「経営者にしかできないデザイン」を考えていただくセミナーを開催した。

③ 映像制作技術講習会 (企画連携課 デザイン情報係)

仕事の中で映像を利用した情報発信の機会が増えている。初心者が失敗しがちな注意点をはじめ、本格的な撮影テクニック、機材選びから編集ノウハウまで実習を交えながら「映像技術の基礎」を学ぶ講習会を開催した。

④ 機械設計基礎講座 (基盤技術課 設計計測係)

機械設計者は設計から加工まで、広い知識が必要とされる設計技術者を対象に、設計・製図に必要な材料・加工等の知識や寸法公差・幾何公差の知識について習得する講座を開催し、設計技術力の高い人材の育成を図った。

⑤ 3D 技術活用セミナー (基盤技術課 設計計測係)

3D CAD、3D プリンタ、3D スキャナなど 3D 技術及びその周辺技術の最新動向を紹介し、ものづくり企業の技術と製品開発力の向上、人材育成を支援するセミナーを開催した。

⑥ ものづくり先端技術セミナー (基盤技術課 材料評価係)

ものづくり技術開発の高度化の促進を目的にした、新機能材料、表面処理技術、精密加工技術、計測評価技術等の先端的技術情報に関するセミナーを開催した。

⑦ 化学技術セミナー (基盤技術課 化学分析係)

新しい機能材料、加工技術、分析技術や国内外の化学物質規制などの情報を提供した。また、RoHS 規制等の国際的化学物質規制や国内の環境関連法令への対応を支援した。

- III
- ⑧ 電磁波技術セミナー (応用技術課 電気通信係)
5G通信などのマイクロ波・ミリ波や電磁ノイズ対策(EMC)など、電磁波に関する様々な技術に関するセミナーを開催した。
- ⑨ 光ものづくりセミナー (応用技術課 電気通信係)
光関連技術分野の製品開発を行っている企業や、これから新規分野に進出を図りたいと考えている企業を対象に、光関連技術のトレンドや話題の提供を行うセミナーを行った。
- ⑩ 食品・バイオ技術セミナー (応用技術課 食品バイオ係)
食品・バイオ関連技術分野の製品開発・製造・販売を行っている企業を対象に、『おいしさの科学的評価』と『食品の寿命を延ばす』の2つのセミナーを開催し、食品市場動向から見る技術開発の方向性等の新しい技術情報を提供した。
- ⑪ 表面技術セミナー (応用技術課 表面構造係)
表面処理技術や評価技術、話題となっている製品、材料、加工技術等に関する幅広い情報の提供や大学等の研究シーズの発信を行うとともに、企業連携につながる研究テーマの発掘を目的としたセミナーを開催した。
- ⑫ IoT 実習セミナー (中丹技術支援室)
デジタルトランスフォーメーション (DX) を進める上で欠かせない、電子部品をコントロールするために必要な基礎知識とプログラミングを、参加者自らがPCと試作ボードを使って学ぶ、実習中心のセミナーを開催した。
- ⑬ 機器操作・活用セミナー (中丹技術支援室)
中小企業の技術者自らが当センター中丹技術支援室の機器類を操作、活用するとともに、より多くの評価を行い、生産現場での問題解決の幅を広げることができるようにする実習形式のセミナーを行った。
- ⑭ 工業技術研修 (中丹技術支援室)
綾部工業研修所(事務局:綾部商工会議所)と共催し、基礎技術力を高めて地域の若手技術者の養成を図る、機械科コースと電気科コースの研修を開催した。
- ⑮ 新分野進出支援講座 (中丹技術支援室)
中小企業の新分野への進出や展開を支援するため、塑性加工技術、障がい者支援ツール、人協働ロボットの紹介等を行った。

⑯ 品質管理(QC)講座 (中丹技術支援室)

ものづくりの現場における生産管理力の向上と、製品の信頼性向上のために重要な品質管理の知識を習得する講座で、QC 検定 3 級レベルの基礎コースと、2 級レベルの上級コースを開催した。

⑰ 産業人材育成基礎講座 (中丹技術支援室)

中丹地域に立地する企業の技術者を対象にした、基礎的な知識を体系的に学べる講座を行った。表面処理技術に関する講座を開催した。

⑱ 京都大学宇治キャンパス産学交流会 (けいはんな分室)

京都大学宇治キャンパスにある 4 研究所(化学研究所、エネルギー理工学研究所、生存圏研究所、防災研究所)との産学交流会を開催した。

⑲ けいはんな産学公交流会 (けいはんな分室)

(公財) 京都産業 21 との共催により、けいはんな学研地域に立地する企業の若手研究者の人材育成を目的に、大学、研究機関との産学公交流会を開催した。

2 研究生・実習生の受け入れ

中小企業の技術者・研究者等の技術開発力・研究能力の向上を支援するため、研究生として受け入れ、技術研修や共同研究を行った。また、大学からの依頼を受け学生を実習生として受け入れ、実習指導を行った。

表 10 研究生等の受託実績

年度 種別	H30	R1	R2	R3	R4
研究生	262 (6)	233 (5)	96 (1)	180(3)	144(2)
実習生	161 (7)	59 (4)	147 (4)	3(3)	29(3)
合計	423 (13)	292 (9)	243 (5)	183(6)	173(5)

注：延べ受入日数（人日）及び（ ）書きで受入実人数を掲載

3 中小企業への啓発等

(1) 京都府中小企業技術センター協力会への支援

京都府中小企業技術センター協力会に対して、情報誌や技報をはじめとする各種情報提供、ホームページでの会員企業の紹介や交流事業の開催など、会員企業の発展に資する取組を実施。コロナ禍で延期となっていた協力会創立 50 周年記念イベントを開催したほか、会員企業を訪問してセンター事業等に対する意見を直接聞くことによりセンター業務への反映や協力会事業の充実を図った。

表 11 センター協力会交流事業実績

実施日	事業内容	参加者
11月29日 13:30～17:00	創立 50 周年記念イベント 第 1 部 講演会「DX 基礎と事例紹介」 ①「DX 基礎～アナログじゃダメなんですか?～」 前川 佳一 氏 / 京都大学 経営管理大学院 特定教授 ②「DX (デジタル変革) に挑む、京都の町工場 ～AI/IoT を活用し、既存事業と自社製品量産の両立化を図る～」 坂 栄孝 氏 / (株) 坂製作所 代表取締役 ③「データと社内人材を活用した工場稼働改善事例」 桃井 秀幸 氏 / サンシード (株) 代表取締役 第 2 部 ポスターセッション ・ 京都府中小企業技術センターの研究成果発表 委託研究 ・ 「グラフェンの光学デバイス用透明電極としての特性評価」 吉木 啓介 氏 / 兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 特任准教授 ・ 会員企業による事業紹介、製品展示	41 名
12月14日	見学会 ①福井県工業技術センター ・ つながる工場テストベッド事業 ・ ふくいロボットテクニカルセンター ②ふくい DX オープンラボ	11 名

表 12 主な研究会・セミナー等実施概要

名 称	回数	延べ参加者数 (Web 参加・視聴 を含む)	担当課・室
研 究 会			
① 新工芸研究会	12	181	企画連携課
② ものづくり分析評価技術研究会	4	119	基盤技術課
③ 京都光技術研究会	8	198	応用技術課
④ 京都実装技術研究会	3	101	
⑤ 表面処理技術研究会	2	43	
⑥ デジタルマニファクチャリング研究会	8	69	中丹技術支援室
⑦ 製品開発企画研究会	3	37	
セミナー・講習会等			
① 企業情報化支援セミナー	2	436	企画連携課
② 京都グッドデザイン戦略支援セミナー	2	115	
③ 映像制作技術講習会	3	8	
④ 機械設計基礎講座	3	55	基盤技術課
⑤ 3D 技術活用セミナー	2	58	
⑥ ものづくり先端技術セミナー	4	109	
⑦ 化学技術セミナー	1	21	
⑧ 電磁波技術セミナー	4	78	応用技術課
⑨ 光ものづくりセミナー	2	70	
⑩ 食品・バイオ技術セミナー	2	84	
⑪ 表面技術セミナー	2	68	
⑫ IoT 実習セミナー	9	141	中丹技術支援室
⑬ 機械操作・活用セミナー	4	3	
⑭ 工業技術研修	99	1,150	
⑮ 新分野進出支援講座	5	65	
⑯ 品質管理(QC)講座	9	510	
⑰ 産業人材育成基礎講座(金属マテリアル基礎講座)	13	680	
⑱ 京都大学宇治キャンパス産学交流会	5	365	けいはんな分室
⑲ けいはんな産学交流会	1	11	
その他(研究成果発表会他)	16	262	
合 計	228	5,037	

IV 研究開発

1 所内研究、共同研究

研究については、以下を基本として実施した。

- ・ ものづくり基盤技術の高度化や企業・業界ニーズに基づく研究
- ・ 中小企業にとって今後展開が見込まれる分野での技術蓄積（ものづくり技術の厚みを増す）を支援する研究
- ・ 新産業創出や成長分野に係る研究
- ・ 重点課題項目に関する研究

(1) 職員による研究調査

① 面粗さ測定時の測定手法の検討② (基盤技術課)

R2 年度研究「面粗さ測定時の測定手法の検討」により、測定間隔を決定する際の目安となる手法について検討を行い、より広い面積を短時間で測定可能であることが判ったが、さらなる検討のために、より広い面積を評価するためには、うねりの影響を無視できない。しかしながら、うねりの影響を考慮した評価を行うための領域及びネスティングインデックスについては検討が不足しているため、本研究では主に、面粗さ測定時の評価領域及びネスティングインデックスを決定する際の目安となる手法について検討を行った。

② 種々のゴム材料劣化状況における広域分光分析とデータベース化に関する研究 (基盤技術課)

種々のゴム材料について劣化促進試験(①熱②温水③紫外線④薬品⑤油)を実施した。その上で、当センターが保有する各種分光分析機器を用いてスペクトルを取得し、従来よりも俯瞰的にゴム材料劣化とスペクトルの相関性を議論するとともに、整理したデータについてデータベース化して一般に公開した。

③ 液中プラズマを用いた有機フッ素化合物の分解における共存物質の影響 (基盤技術課)

有機フッ素化合物は撥水剤や界面活性剤、半導体製造用の表面処理剤などに使用されているが、環境中で分解されにくく、高い蓄積性を有するため適切な処理が求められている。有機フッ素化合物は廃水中で様々な物質と共存し、分解効率は共存物質との反応性やその濃度に依存すると考えられる。本研究では液中プラズマを用いた有機フッ素化合物の分解における共存物質の影響を評価した。

④ DFFC 法における電磁波シールド性能評価にかかる検討 (応用技術課)

DFFC 法は 1GHz から 15GHz までの電磁波シールド性能を評価できる手法であるが、比較的新しい手法であり、試料の形状・性状による影響についての知見が少ない。本研究では試料の厚さや伝導処理などの影響について系統的な評価を実施することで、手法の適応範囲について明確化を試みた。

⑤ 音声を用いたレトロフィット IoT の開発 (応用技術課)

近年注目を集めている IoT 技術は、デジタル化社会の要となる技術であり、製造業はもちろんのこと、1次・3次産業など様々分野での活躍が期待される場所である。しかしながら、既存の機器やシステムの多くはデジタル化に対応できているところでない。本研究では、音声を用いた入出力機構の可能性について具体事例への適応から検討した。

⑥ HFSS によるマイクロ波・ミリ波測定のシミュレーション (応用技術課)

電磁界シミュレータ(HFSS)を使用して、当センターで電磁波の測定に供している機器をコンピュータ上に再現することで、測定結果をシミュレータ上でも検証できるように試みた。

⑦ ガラスレンズの成形シミュレーション (中丹技術支援室)

レンズの製造過程であるガラスモールド成形は、加熱温度やプレス時間などの条件によって最終の性能に大きな影響を受ける。本研究では加熱工程からガラスモールドの粘弾性のシミュレーションを行い、成型条件等による影響を調査した。

⑧ 未反応モノマーの分析の検討 (中丹技術支援室)

エポキシ樹脂やフェノール樹脂など 2 液硬化樹脂中の未反応モノマーをガスクロマトグラフ質量分析により評価する方法について検討した。

2 受託研究

中小企業等の技術課題の解決や新技術又は新製品の開発等につなげるため、中小企業等の依頼に応じて、研究、試験分析等を 2 件受託した。

3 委託研究

・新規狭帯域バンドパスフィルタの検討 (委託先：京都工芸繊維大学 井上助教)

光導波路薄膜表面を微細加工することによって得られる入射角度低依存の狭帯域バンドパスフィルタを提案し、その実現可能性を実験的に検証するため、シリコン薄膜への電子ビーム直接描画リソグラフィと反応性イオンエッチングによる試料作製と、評価実験を実施した。

4 研究課題評価

業界のニーズや課題解決のための研究推進、府民理解の促進、研究者の創造性の向上と柔軟で競争的な研究環境の創出、より効果的・効率的な研究の促進のために、センターが実施する研究課題について、内部評価検討会議及び外部の有識者で構成する外部評価委員会で評価を行い、評価結果の公表を行った。

5 知的財産の活用

研究開発等から得られた成果を積極的に外部へ公表するとともに、知的財産として保護すべきものについては、府として出願・権利化を行い京都府知的財産総合サポートセンターとも連携しながら、企業等への技術移転やホームページ、各種展示会等において、当センター保有の知的財産の広報を行った。

さらに知的財産権やノウハウ、人材、技術力等の目に見えない企業の強みである知的資産を活かす知的資産経営（知恵の経営）を推進するため、京都府知的財産総合サポートセンターや（公財）京都産業 21 と連携し、知財・技術・経営のワンストップサービスを強化した。^{（注）}（注）共有の特許権の場合は、共有者の了解が得られたものに限る。

表 13 保有特許一覧（令和5年3月31日現在）

登録年	発 明 の 名 称	登録番号
平成 26 年	「卵麴由来の調味料及びその製造方法」	5467289
平成 26 年	「マイクロバブルを利用したメッキ排水処理方法およびその方法に用いられるメッキ排水処理用薬液」	5560447
平成 27 年	「高電圧スイッチ回路およびこれを用いた X 線パルス発生装置」	5821050
平成 29 年	「漬物の製造方法」	6149249
平成 30 年	「乳製品乳酸菌飲料の製造方法」	6340513
令和元年	「乳酸菌およびこれを用いた乳製品乳酸菌飲料の製造方法」	6518909
令和 3 年	「乳酸発酵豆乳の製造方法」	6829430

6 企業との協働による具体的な技術開発の推進

企業連携技術開発支援事業

企業連携による新たな技術開発や新事業展開のために、イノベーション創出を目指し研究開発を行っている企業グループ等を対象に、技術課題の解決等を支援した。

支援にあたっては、企業グループとセンター職員等が試作開発等の検討・調整、必要な種々の技術や評価法を相談・解決する協働スペースである「企業連携技術開発室」を活用した。

表 14 企業連携技術開発支援事業一覧

年度	研究開発の名称	連携職員
R 3～R 5	京都光るファイバーにおける実用化の検討	応用技術課 電気通信係

7 研究発表・出講

表 15 出講状況一覧表

実施日	名称	場所	回数	延べ人数	講師
6月18日	京都文化資本アカデミー 公開セミナー	成徳学舎（旧成徳中学校）及びWeb	1	57	企画連携課 古郷副主査
9月26日	京都金属プレス高度技術 学院塑性加工講座（材料 の基礎）	当センター	1	23	基盤技術課 倉橋主任研 究員 谷田主任
10月24日	京都金属プレス高度技術 学院塑性加工講座（めっ き技術の基礎）	清水長金属工業（株）	1	24	応用技術課 中村副主査
11月11日	産業技術支援フェア In KANSAI 2022	大阪産業創造館	1	約 450	基盤技術課 渡部副主査 谷田主任
12月7日	第39回メカトロニクス 研究会材料力学講座	京都工業会	1	15 (含Web5)	坂之上所長
12月10日	市民大学院研究会「京都 の文化資源を生かした産 業創出と地域振興」	成徳学舎（旧成徳中学校）及びWeb	1	19	企画連携課 福岡課長

※ 延べ人数は一部主催者発表の数値を記載している。

V 関係機関との連携

1 広域での公設試験研究機関の連携

産業技術連携推進会議などを通じて他の公設試験研究機関及び国立研究開発法人産業技術総合研究所と連携・協力し、各技術分野、地域の技術力向上などを図った。

また、11月に発足した「関西広域産業共創プラットフォーム事業」において関西広域連合内の11公設試験研究機関を中心とした各機関と連携し、情報の共有・活用・発信、設備の域内利用の促進等に取り組んだ。

2 産業支援機関との連携

(公財)京都産業21、京都府知的財産総合サポートセンターと当センターの三者による連携を強化し、経営・技術・知的財産のワンストップ支援体制を充実した。

3 大学との連携

最新の技術動向に対応できる専門家の発掘を推進し、特別技術指導員等の人脈を補強するとともに大学との共同研究を推進した。

また、企業ニーズに基づく新事業展開や大学の技術シーズの企業への移転の橋渡し、大学との共同研究を推進した。

4 業界団体等との連携

(1) 溶接技術指導事業

ものづくりの基盤技術である溶接技術の向上を図るため、(一社)京都府溶接協会等関連団体と連携した。

(2) 表面処理技術支援事業

めっき業を中心とする表面処理業においては、亜鉛等の規制強化に伴う排水処理を含めた製造工程の管理と改善並びに発注先の厳しい要求に応える品質管理が求められている。この現状に対応する技術支援、情報提供と併せて現場で生じている課題解決に向けた提案を行った。

VI 情報発信

1 中小企業等への情報提供の強化と、広く府民の皆さんへの広報

広報を通じて当センターをより知っていただくとともに、日々の技術支援業務の円滑かつ効果的な推進に役立つよう取り組んだ。

表 16 情報発信実施状況

内 容		実 績	備 考
ホームページ (https://www.kptc.jp/)	閲覧件数	268,576PV	PV(ページビュー)：ページが開かれた回数
メールマガジン	発行回数	49回	
情報誌 「クリエイティブ京都 M&T」	発行回数	4回	年4回(季刊)
	発行部数	各回6,000部	ホームページにも掲載

2 施設の公開

当センターの活用の幅を広げていただくとともに、より多くの企業や府民の皆さんに当センターの役割や機能を知っていただくために、施設公開や視察・研修受け入れを実施した。

表 17 主な視察等受入れ実績
(本所)

月 日	団体等の名称	人 数
7月4日、5日	京都府立工業高等学校	2
7月22日	京都航空宇宙産業ネットワーク	13
8月5日～26日 のうち10日間	龍谷大学	29人(うちWeb1)
8月17日	QUANTUMSCAPE JAPAN(同)	1
11月22日	(地独)京都市産業技術研究所	3
11月24日	(独)中小企業基盤整備機構近畿本部	3
2月1日	(公財)京都工業会	14

(中丹技術支援室)

月 日	団体等の名称	人数
4月21日	福知山公立大学	3
7月26日	ものづくり体験ツアー（小学生）	32

3 ニーズの変化に対応した情報の提供

中小企業の技術的諸課題の解決に向けて実施した研究や調査の結果をとりまとめて発行した。また、毎年夏に実施している研究成果発表会を令和4年度は「研究成果の発表と業務紹介」としてオンライン配信するとともに、センター協力会のイベント内でポスターセッションを行うなど広く情報発信した。

表 18 研究成果の発表等概要

事業名	研究成果の発表と業務紹介
期 間	令和4年8月1日（月）～8月31日（水）
方 法	オンライン配信
内 容	<ul style="list-style-type: none">○ 研究成果の発表 職員が取り組んだ研究開発や調査研究の成果の普及、実用化のための発表等○ 支援業務の紹介 研究成果について担当職員に質問や意見交換ができる場

事業名	協力会創立50周年記念イベント第2部
日 時	令和4年11月29日（火）午後4時～5時
場 所	京都リサーチパーク1号館4階サイエンスホール
内 容	ポスターセッション（研究成果発表）

表 19 研究成果の発行物

名 称	内 容
技報 N0.50	令和3年度に実施した研究等の成果

Ⅶ 地域産業の活性化

1 北部地域ものづくり産業振興

(1) デジタルマニファクチャリング推進事業 【再掲】

中丹地域のものづくり企業が CAE を用いた設計・シミュレーション解析・試作・評価の一連の流れを体感できる研究会を開催した。

(2) 新分野進出支援事業（新分野進出支援講座） 【再掲】

地域の中小企業の新分野への取り組みを支援するための講座を開催した。新たな技術の修得や新分野進出につながる内容で実施した。

(3) 人材育成事業【再掲】

府北部の人材を育成するために、デジタルマニファクチャリング研究会、IoT 実習セミナー、工業技術研修、産業人材育成基礎講座などを開催した。

表 20 研究会・セミナー等一覧

名 称	回数	延べ参加者数
デジタルマニファクチャリング研究会	8 回	69 名
製品開発企画研究会	3 回	37 名
IoT 実習セミナー	9 回	141 名
機器操作・活用セミナー	4 回	3 名
工業技術研修	99 回	1,150 名
新分野進出支援講座	5 回	65 名
品質管理(QC)講座	9 回	510 名
産業人材育成基礎講座	13 回	680 名

2 けいはんな地域における大学・研究機関と企業との連携推進

(1) 大学・研究機関と府内中小企業のマッチング

学研都市を中心とした府南部及びけいはんな地域に立地する大学・研究機関と府内企業の技術シーズとそれを活用したい企業との出会いの場を提供するため、京都大学宇治キャンパスとの産学交流会を開催した。

表 21 交流会開催状況一覧

名 称	回 数	延べ参加者数
京都大学宇治キャンパス産学交流会	5 回	365 名
けいはんな産学交流会	1 回	11 名

(2) 課題解決支援

新製品・新技術開発を目指す企業・業界団体が抱えている具体的な技術課題の解決を支援した。

VIII 技術支援体制の充実・強化

地域の中小企業等に満足いただける技術支援を行うために、当センター内部において技術支援体制の充実・強化に取り組んだ。

1 技術職員の資質向上

中小企業の期待に応えられる技術・知識、評価・提案力、研究開発力や他機関等とのコーディネート力の向上を図るため、企業技術者と技術職員が共に学ぶ研究会・セミナーの実施や以下の取り組みを行った。

- ① 各企業のものづくり現場への積極的な訪問
- ② 研修会・講習会・学会への参加
- ③ 計画的な研修機関・研究機関への派遣

2 機器利用者への支援体制強化

機器利用者の利便性向上と利用ノウハウの蓄積・共有を図るため、分析装置、試験・測定装置等の主要機器についてジョブローテーションを行い、複数担当体制の強化を図った。

3 知的財産の管理

当センターの知的財産権の取得・活用等の考え方をまとめた「知的財産権ポリシー」を適正に運用するとともに、関係機関等との情報交換に努め、知的財産の適切な管理・活用を図った。

4 機器の整備

製造業における合理化、品質管理、製品開発を支援するため、試験研究用機器の機能拡充を計画的に行った。令和4年度は表22と表23の2つの機器を導入した。

表 22 令和4年度導入機器

<p>波長分散型蛍光X線分析装置</p> <p>((公財)JKAの補助事業利用)</p>	<p>この装置は、試料にX線を照射したときに発生する蛍光X線を分光することにより元素を分析する。</p> <p>金属やセラミックスなどの固体材料に含まれる元素を非破壊で、迅速かつ高感度に分析することができる。</p> <p><機器の特徴></p> <ul style="list-style-type: none"> ・測定範囲 ${}^4\text{Be}\sim{}^{96}\text{Cm}$ ・X線管 Rhターゲット、最大定格 4kW ・測定径 $\Phi 30、20、10、1\text{mm}$ <p><主な用途></p> <ul style="list-style-type: none"> ・材料の成分分析を行い、添加元素や不純物の同定、規格との照合を行う。 ・製品や部品に発生した変色や混入した異物の成分分析を行い、正常な部分との比較により評価する。
--	--

表 23 令和4年度導入機器

<p>高速液体クロマトグラフ (HPLC)</p> <p>((公財)JKAの補助事業利用)</p>	<p>この装置では、充填剤が詰められたカラム(固定相)に液体(移動相)を流すことで試料中の各成分を分離し、定性・定量分析を行うことができる。蛍光検出器によるアミノ酸分析(プレカラム誘導体化法、電気伝導度検出器による有機酸分析(ポストカラムpH緩衝法)、示差屈折率検出器による糖分析、PDA検出器による核酸分析等、様々な成分の分析が可能である。</p> <p><機器の特徴></p> <ul style="list-style-type: none"> ・送液ポンプ:移動相ブレンディング機能(最大8液) ・オートサンプラ:プレカラム誘導体化機能、オーバーラップ分析機能 ・検出器:フォトダイオードアレイ、示差屈折率、蛍光、電気伝導度 <p><主な用途></p> <ul style="list-style-type: none"> ・食品の栄養成分・機能性成分 ・化成品の含有成分・添加物等の分析
---	---

5 業務運営に係る基盤的事項

当センターの限られた資源を活用し、府内中小企業の技術支援を効果的に行う事務・事業を実施するため、予算を効率的に執行するとともに、「物品管理マニュアル」に基づいて適正な物品管理を行った。

(事業運営懇談会の開催)

当センターの事業運営全般について、産業界や学識経験者等の外部有識者から意見・助言を得る事業運営懇談会を開催した。

3月2日	外部有識者8名
------	---------

(参考)

審査会等への出席一覧

開催日	名称	場所	担当課室	出席者
4月6日	京都府溶接技術競技会 運営委員会	ポリテクセンター京都	基盤技術課	中西課長 服部主任研究員 倉橋主任研究員
5月13日	京都府溶接技術競技会 審査委員会	ポリテクセンター京都	基盤技術課	倉橋主任研究員 谷田主任
5月14日	京都府溶接技術競技会	ポリテクセンター京都	基盤技術課	四辻副所長 中西課長 倉橋主任研究員 谷田主任
5月23日	知恵の経営認定審査会	京都リサーチパーク		坂之上所長
5月26日	応援条例意見聴取会議	中小企業技術センター		四辻副所長
6月7日	京都府溶接技術競技会 審査委員会	ポリテクセンター京都	基盤技術課	倉橋主任研究員 谷田主任
6月8日	令和4年度電気めっき技能 検定 全体会議	メテック(株)	応用技術課	松延主任研究員 中村副主査
6月14日	京都府溶接技術競技会 運営委員会	ポリテクセンター京都	基盤技術課	中西課長 倉橋主任研究員 谷田主任
6月24日	第1回表面物性研究会	大阪産業技術研究所 森ノ宮センター	応用技術課	中村副主査
6月28日	第140回意匠保全登録 審査会	西陣織会館	企画連携課	片瀬技師
6月28日	京都府溶接技術競技会 審査委員会	ポリテクセンター京都	基盤技術課	倉橋主任研究員 谷田主任
7月8日	技能検定委員会(機械 検査)(前期)	ポリテクセンター京都	基盤技術課	上原主任研究員
7月9日	技能検定(機械検査) (前期)	ポリテクセンター京都	基盤技術課	上原主任研究員
7月9日	電気めっき実技試験	メテック(株)	応用技術課	松延主任研究員 中村副主査
7月16日	電気めっき実技試験	メテック(株)	応用技術課	松延主任研究員 中村副主査

開催日	名称	場所	担当課室	出席者
7月28日	応援条例意見聴取会議	(公財)京都産業 21		四辻副所長
8月3日	めっき検定採点会議	メテック(株)	応用技術課	松延主任研究員 中村副主査
8月5日, 6日, 28日	熱処理技能検定(委員会、試験)	ポリテクセンター京都、 長浜バイオ大学京都キャンパス	基盤技術課	谷田主任
9月1日	京都府溶接技術競技会 審査委員会	ポリテクセンター京都	基盤技術課	倉橋主任研究員 谷田主任
9月9日	技能検定総括会議	京都市下京区	応用技術課	松延主任研究員 中村副主査
9月26日	知恵の経営認定審査会	京都リサーチパーク		坂之上所長
9月30日	意匠保全登録審査委員会	西陣織会館	企画連携課	福岡課長
10月13日	シルバー美術展審査	京都文化博物館	企画連携課	福岡課長
10月13日, 14日	表面技術分科会	あいち産業技術総合センター産業技術センター	応用技術課	藤河技師
11月7日	京友禅・京小紋伝統工芸士産地委員会	京染会館	企画連携課	福岡課長
11月11日	産業技術支援フェア in KANSAI	大阪産業創造館	基盤技術課	谷田主任
11月24日	応援条例意見聴取会議	(公財)京都産業 21	応用技術課	大藤課長
12月15日, 16日	分析分科会	鹿児島県	基盤技術課	渡部副主査 関 副主査
12月21日	第67回京都府発明等功労者表彰委員会第2回 専門委員会議	ルビノ京都堀川		四辻副所長
1月13日	技能検定委員会(機械検査)(後期)	ポリテクセンター京都	基盤技術課	上原主任研究員
1月14日, 15日	技能検定(機械検査)(後期)	ポリテクセンター京都	基盤技術課	上原主任研究員

開催日	名 称	場 所	担当課室	出席者
1月23日	知恵の経営認定審査会	京都リサーチパーク		坂之上所長
1月26日	応援条例意見聴取会議	(公財)京都産業 21		四辻副所長
1月27日	京都府溶接技術競技会 審査委員会	ポリテクセンター京都	基盤技術課	中西課長 倉橋主任研究員 谷田主任
1月28日	技能検定採点(機械検 査)(後期)	ポリテクセンター京都	基盤技術課	上原主任研究員
2月6日	京都府溶接技術競技会 審査委員会	ポリテクセンター京都	基盤技術課	倉橋主任研究員 谷田主任
2月17日	第67回京都府発明等功 労者表彰委員会第2回 専門委員会議	ルビノ京都堀川		四辻副所長
3月15日～ 17日	第57回日本水環境学会 年会	愛媛県	基盤技術課	渡部副主査

研究会、セミナー・講習会等実績

※延べ人数には、Web参加・視聴を含む

実施日	名称	場所	回数	延人数	うちWeb	講師	共催団体
企画連携課							
4月20日	新工芸研究会	萬重	1	21	-	(株)GK京都 吉田 治英 氏	
4月21日	京都グッドデザイン戦略支援セミナー	当センター/Web	1	32	23	(公財)日本デザイン振興会 川口 真沙美 氏	日本デザイン振興会
5月16日	新工芸研究会	当センター/Web	1	15	1	(株)吉岡甚商店 吉岡 信昌 氏	
5月20日	映像制作技術講習会	当センター/Web	1	3	-	松井主任研究員	
6月20日	新工芸研究会	当センター	1	17	-	(株)吉岡甚商店 吉岡 信昌 氏	
6月21日	企業情報化支援セミナー	Web	1	233	233	NTTコミュニケーションズ(株) 塚本 氏	
6月29日	映像制作技術講習会	当センター	1	1	-	松井主任研究員	
7月25日	新工芸研究会	当センター/Web	1	17	3	(株)吉岡甚商店 吉岡 信昌 氏	
8月22日	新工芸研究会	当センター/Web	1	15	6	京都工芸繊維大学 多田羅 景太 氏	
9月5日	京都グッドデザイン戦略支援セミナー	当センター/Web	1	83	76	iF日本オフィス 代表 高田 昭代 氏 Kanae Design Labo 代表 塚本 カナエ 氏	iF日本オフィス
9月20日	新工芸研究会	当センター	1	12	-	京都工芸繊維大学 多田羅 景太 氏	
10月17日	新工芸研究会	当センター/Web	1	11	2	京都工芸繊維大学 多田羅 景太 氏	
11月28日	新工芸研究会	当センター/Web	1	16	4	京都工芸繊維大学 多田羅 景太 氏 (株)吉岡甚商店 吉岡 信昌 氏	
11月29日	センター協力会創立50周年記念イベント	KRP1号館 サイエンスホール 1	41	41	4	京都大学 経営管理大学院 特定教授 前川 佳一 氏 (株)坂製作所 代表取締役 坂 栄孝 氏 サンシード(株) 代表取締役 桃井 秀幸 氏 兵庫県立大学 特任准教授 吉木 啓介 氏	
12月14日	京都府中小企業技術センター協定会見学会	①福井県工業技術センター ②ふくいDXオーブンラボ	1	11	-		
12月16日	モデル工場会见学会	(株)片岡製作所	1	22	-		
12月19日	新工芸研究会	当センター/Web	1	18	4	京都工芸繊維大学 多田羅 景太 氏	
1月16日	新工芸研究会	当センター/Web	1	12	5	京都工芸繊維大学 多田羅 景太 氏	
1月20日	企業情報化支援セミナー	Web	1	203	203	次世代ロボットエンジニア支援機構 代表理事 川節 巧実 氏	京都府情報産業協会
3月16日	映像制作技術講習会	けいはんな分室	1	4	3	松井主任研究員	
3月27日	新工芸研究会	当センター	1	15	-	京都工芸繊維大学 多田羅 景太 氏	
基盤技術課							
6月15日	ものづくり先端技術セミナー	Web	1	31	31	大塚技術士事務所 所長 大塚 正彦 氏 TC02(株) 正島 宏一 氏	
8月29日	機械設計基礎講座	当センター/Web	1	19	18	QVIジャパン(株) 林 正弘 氏(日本工業大学 非常勤講師)	
9月27日	ものづくり分析評価技術研究会	当センター/Web	1	28	14	関西学院大学 名誉教授・フェロー 尾崎 幸洋 氏 近畿大学 森澤 勇介 氏	
9月28日	機械設計基礎講座	当センター/Web	1	19	17	QVIジャパン(株) 林 正弘 氏(日本工業大学 非常勤講師)	
10月6日	ものづくり先端技術セミナー	Web	1	28	28	奈良先端科学技術大学院大学 中村 雅一 氏	(公財)京都技術科学センター

実施日	名称	場所	回数	延人数	うちWeb	講師	共催団体
10月21日	ものづくり分析評価技術研究会	当センター/Web	1	33	19	(株)右近工舎 右近 寿一郎 氏 (株)島津製作所 鈴木 康志 氏 関西学院大学 名誉教授・フェロー 尾崎 幸洋 氏	
10月26日	3D技術活用セミナー	当センター/Web	1	21	20	(株)ニコンソリューションズ 嶋崎 弘明 氏、和泉 智弘 氏	
11月2日	機械設計基礎講座	当センター/Web	1	17	15	QVIジャパン(株) 林 正弘 氏(日本工業大学 非常勤講師)	
11月9日	ものづくり先端技術セミナー	Web	1	31	31	東京工芸大学 加藤 之貴 氏	
11月25日	ものづくり分析評価技術研究会	当センター/Web	1	29	15	関西学院大学 名誉教授・フェロー 尾崎 幸洋 氏 福井大学 谷 正彦 氏	(公財)京都技術科学センター
12月2日	化学技術セミナー	オンライン	1	21	21	名古屋大学大学院 原 光生 氏	
12月6日	ものづくり先端技術セミナー	当センター/Web	1	19	14	(地独行)大阪産業技術研究所 濱田 真行 主任研究員 山口 拓人 主任研究員	
12月13日	ものづくり分析評価技術研究会	当センター/Web	1	29	15	福井大学 北原 英明 特命助教授 神戸大学 佐藤 春実 氏	(公財)京都技術科学センター
3月13日	3D技術活用セミナー	当センター/Web	1	37	34	東京大学大学院 大竹 豊 氏 (株)デジナル/(株)ExtraBold 原 雄司 氏	
応用技術課							
4月7日	京都光技術研究会	当センター/Web	1	34	22	京都光技術研究会 山下 幹雄 氏 京都工芸繊維大学 粟辻 安浩 氏 神戸大学 的場 修 氏 公立千歳科学技術大学 下村 政嗣 氏	京都光技術研究会
5月24日	京都光技術研究会	当センター/Web	1	27	12	京都光技術研究会 山下 幹雄 氏 京都工芸繊維大学 粟辻 安浩 氏 (株)大興製作所 須田 真通 氏	京都光技術研究会
6月23日	表面処理技術研究会	当センター/Web	1	17	15	中村副主査	鏡秀会
6月30日	京都実装技術研究会	当センター/Web	1	46	41	(株)産業タイムズ社 泉谷 渉 氏	京都実装技術研究会
7月29日	京都光技術研究会	当センター/Web	1	21	6	京都光技術研究会 山下 幹雄 氏 京都工芸繊維大学 粟辻 安浩 氏 神戸大学 的場 修 氏 富士化学(株) 川中 智司 氏	京都光技術研究会
8月4日,31日	電磁波技術セミナー	当センター/Web	2	51	40	(一社)KEC関西電子工業振興センター 中山 太介 氏 (一社)KEC関西電子工業振興センター 疋田修一 氏 奈良工業高等専門学校 声原 佑樹 氏	(公財)京都技術科学センター
8月23日	京都光技術研究会	当センター/Web	1	25	10	京都光技術研究会 山下 幹雄 氏 京都工芸繊維大学 粟辻 安浩 氏 神戸大学 的場 修 氏 同志社大学 田中 智子 氏 (株)オプト・システム 池田 研一 氏	京都光技術研究会
8月26日	京都実装技術研究会	当センター/Web	1	27	26	(有)実装彩科 斉藤 和正 氏	京都実装技術研究会
9月1日	食品・バイオ技術セミナー	当センター/Web	1	44	34	京都女子大学 成川真隆 氏 長谷川香料(株) 野尻健介 氏	
9月9日	電磁波技術セミナー	Web	1	17	17	ウルト・エレクトロニクス・ジャパン(株) 廣田 大輔 氏	(公財)京都技術科学センター
9月29日	表面処理技術研究会	当センター/Web	1	24	22	(株)三進製作所技術研究所 北川 富則 氏	
10月25日	表面技術セミナー	Web	1	29	29	金沢大学 ナノ生命科学研究所 特任教授 安藤 敏夫 氏 東北大学 多元物質科学研究所 百生 敏 氏	
10月27日	京都光技術研究会	当センター/Web	1	19	6	京都光技術研究会 山下 幹雄 氏 京都工芸繊維大学 粟辻 安浩 氏 神戸大学 的場 修 氏 同志社大学 田中 智子 氏 TOWAレーザーフロント(株) 戸川 拓哉 氏	京都光技術研究会
11月11日	電磁波技術セミナー	当センター	1	10	-	ムラタソフトウェア(株) 五嶋 制二 氏	(公財)京都技術科学センター
11月22日	京都光技術研究会	研修室等	1	25	10	京都光技術研究会 山下 幹雄 氏 京都工芸繊維大学 粟辻 安浩 氏 神戸大学 的場 修 氏 同志社大学 田中 智子 氏 農林センター 竹本 哲行 主任研究員	京都光技術研究会
12月19日	光ものづくりセミナー	当センター/Web	1	37	25	東京工芸大学 渋谷 真人 氏 京都工芸繊維大学 村上 久 氏 (株)棚場製作所 高木 陽一 氏 京都光技術研究会 山下 幹雄 氏	京都光技術研究会
1月17日	食品・バイオ技術セミナー	当センター/Web	1	40	26	大阪大学 福崎 英一郎 氏 太陽日酸(株) 石渡 由剛 氏	
1月20日	京都実装技術研究会	当センター/Web	1	28	20	ANDO実装技術研究所 当田 真行 氏	京都実装技術研究会

実施日	名称	場所	回数	延人数	うちWeb	講師	共催団体
1月26日	京都光技術研究会	当センター/Web	1	21	6	京都光技術研究会 山下 幹雄 氏 京都工芸繊維大学 栗辻 安浩 氏 神戸大学 的場 修 氏 同志社大学 田中 智子 氏	京都光技術研究会
2月21日	京都光技術研究会	当センター/Web	1	26	6	京都光技術研究会 山下 幹雄 氏 京都工芸繊維大学 栗辻 安浩 氏 神戸大学 的場 修 氏 同志社大学 田中 智子 氏 (株)トフコンテック/ハウス 田中 博之 氏	京都光技術研究会
3月1日	表面技術セミナー	当センター/Web	1	39	33	福井大学 米沢 晋 氏	
3月27日	令和4年度電気めっき排水処理巡回指導報告会	当センター/Web	1	24	11	東ソー(株)有機材料研究所 服部 正寛 氏 中村副主査 藤河 技師	京都府鍍金工業組合
3月28日	新規導入機器「高速液体クロマトグラフ(HPLC)」説明会	当センター	1	9	-	(株)島津製作所 品玉 匠司 氏	
中丹技術支援室							
4月5日,12日,19日,26日	工業技術研修(機械コース)	中丹技術支援室	4	38	-	日東精工(株) 技術担当者	
4月7日,14日	工業技術研修(電気コース)	中丹技術支援室	2	13	-	日東精工(株) 技術担当者	
5月10日,17日,24日,31日	工業技術研修(機械コース)	中丹技術支援室	4	36	-	日東精工(株) 技術担当者	
5月12日,19日,26日	工業技術研修(電気コース)	中丹技術支援室	3	28	-	日東精工(株) 技術担当者	
6月2日,9日,16日,23日,30日	工業技術研修(電気コース)	中丹技術支援室	5	49	-	日東精工(株) 技術担当者	
6月7日,14日,20日,29日	産業人材育成基礎講座(表面処理)	中丹技術支援室/Web	4	246	242	向原技術士事務所 向原 文典 氏 京都大学大学院 平藤 智司 氏 奥野製薬工業(株) 長尾 敏光 氏	
6月7日,14日,21日,28日	工業技術研修(機械コース)	中丹技術支援室	4	39	-	日東精工(株) 技術担当者	
6月17日,24日	品質管理講座(基礎講座)	中丹技術支援室/Web	2	148	143	MY中小企業診断士・技術士事務所 山口 誠 氏	
6月23日	製品開発企画研究会(環境配慮型製品開発)	Web	1	16	16	秋田大学大学院 三島 望 氏	
7月1日,8日,15日	品質管理講座(基礎講座)	中丹技術支援室/Web	3	222	219	SASAものづくり研究所 佐々木 孔基 氏	
7月5日,12日,20日	産業人材育成基礎講座(表面処理)	中丹技術支援室/Web	3	166	163	奥野製薬工業(株) 福爪 佳 氏 北 晃治 氏 日本パーカライジング(株) 嶋本 晋 氏	
7月5日,12日,19日,26日	工業技術研修(機械コース)	中丹技術支援室	6	54	-	日東精工(株) 技術担当者	
7月7日,14日,21日,28日	工業技術研修(電気コース)	中丹技術支援室	5	56	-	日東精工(株) 技術担当者	
7月22日,29日	品質管理講座(上級講座)	Web	2	70	70	(有)板井経営技術事務所 坂井 公一 氏	
7月28日	製品開発企画研究会(環境配慮型製品開発)	Web	1	14	14	秋田大学大学院 三島 望 氏	
8月2日,9日,23日,30日	工業技術研修(機械コース)	中丹技術支援室	7	45	-	日東精工(株) 技術担当者	
8月3日,31日	産業人材育成基礎講座(表面処理)	中丹技術支援室/Web	2	103	101	コアマシナリー(株) 岡本 真樹 氏 日本アイ・ティ・エフ(株) 瀬戸山 誠 氏	
8月4日,18日,25日	工業技術研修(電気コース)	中丹技術支援室	5	69	-	日東精工(株) 技術担当者	
8月5日,19日	品質管理講座(上級講座)	Web	2	70	70	(有)板井経営技術事務所 坂井 公一 氏	
8月26日	製品開発企画研究会(環境配慮型製品開発)	中丹技術支援室	1	7	-	秋田大学大学院 三島 望 氏	
9月1日,8日,15日,22日,29日	工業技術研修(電気コース)	中丹技術支援室	9	147	-	日東精工(株) 技術担当者	
9月6日,13日,21日,29日	産業人材育成基礎講座(表面処理)	中丹技術支援室/Web	4	165	161	(株)KOYO熱錬 杉本 卓也 氏 富士電子工業(株) 中井 晴文 氏 大阪産業大学 南部 隆一郎 氏 (株)峰山メッキ 綱 和彦 氏	
9月6日,13日,27日	工業技術研修(機械コース)	中丹技術支援室	6	52	-	日東精工(株) 技術担当者	
9月14日	IoTオープンセミナー	中丹技術支援室/Web	1	37	28	舞鶴電腦工作室(同) 町田 秀和 氏 クロー電機(株) 藤井 正敏 氏	
9月27日	デジタルマニファクチャリング研究会	中丹技術支援室/Web	1	9	8	(株)くいと 月野 氏	
10月4日,5日,6日	デジタルマニファクチャリング研究会	中丹技術支援室 けいはんな分室 本所	3	9	-	(株)くいと 月野 氏	
10月4日,11日,18日,25日	工業技術研修(機械コース)	中丹技術支援室	4	26	-	日東精工(株) 技術担当者	
10月6日,13日,20日,27日	機器操作・活用セミナー	中丹技術支援室	4	3	-	中丹技術支援室職員	
10月6日,13日,20日,27日	工業技術研修(電気コース)	中丹技術支援室	4	88	-	日東精工(株) 技術担当者	
10月17日,24日,31日	IoT実習セミナー(基礎講座)	中丹技術支援室	3	30	-	舞鶴電腦工作室(同) 町田 秀和 氏	

実施日	名称	場所	回数	延人数	うちWeb	講師	共催団体
11月1日	デジタルマニファクチャリング研究会	中丹技術支援室	1	5	-	(株)くいんと 月野 氏	
11月7日	IoT実習セミナー(基礎講座)	中丹技術支援室	1	10	-	舞鶴電脳工作室(同) 町田 秀和 氏	
11月8日,15日,22日,29日	工業技術研修(機械コース)	中丹技術支援室	4	27	-	日東精工(株) 技術担当者	
11月10日,17日,24日	工業技術研修(電気コース)	中丹技術支援室	3	61	-	日東精工(株) 技術担当者	
11月11日	IoTオープンセミナー(延期分)	Web	1	34	34	福知山公立大学 衣川 昌宏 氏 マックスブレインコンピュータサービス 勝田 憲弘 氏	
11月28日	IoT実習セミナー(応用講座)	中丹技術支援室	1	8	-	舞鶴電脳工作室(同) 町田 秀和 氏	
12月1日,8日,15日	工業技術研修(電気コース)	中丹技術支援室	3	67	-	日東精工(株) 技術担当者	
12月2日,16日	新分野進出支援講座(塑性加工技術)	中丹技術支援室/Web	2	26	24	京都工芸繊維大学 飯塚 高志 氏	
12月5日,12日,19日	IoT実習セミナー(応用講座)	中丹技術支援室	3	22	-	舞鶴電脳工作室(同) 町田 秀和 氏	
12月6日,13日	工業技術研修(機械コース)	中丹技術支援室	2	14	-	日東精工(株) 技術担当者	
1月13日,20日	新分野進出支援講座(塑性加工技術)	中丹技術支援室	2	20	18	京都工芸繊維大学 飯塚 高志 氏	
1月17日,31日	工業技術研修(機械コース)	中丹技術支援室	2	11	-	日東精工(株) 技術担当者	
1月19日	工業技術研修(電気コース)	中丹技術支援室	1	21	-	日東精工(株) 技術担当者	
2月2日,9日,16日	工業技術研修(電気コース)	中丹技術支援室	3	60	-	日東精工(株) 技術担当者	
2月7日,14日,21日,28日	工業技術研修(機械コース)	中丹技術支援室	4	25	-	日東精工(株) 技術担当者	
3月2日,9日,16日,23日,30日	工業技術研修(電気コース)	中丹技術支援室	5	103	-	日東精工(株) 技術担当者	
3月7日,14日,28日	工業技術研修(機械コース)	中丹技術支援室	3	21	-	日東精工(株) 技術担当者	
3月23日	新分野進出支援講座(体験)	中丹技術支援室	1	19	-	舞鶴工業高等専門学校 丹下 裕 氏 (株)安川電機 今里 康宏 氏	

けいはんな分室

6月6日	けいはんな産学交流会	けいはんなプラザ	1	11	-	ATR 宮下 敬宏 インスタレーション科学研究所長 (株)コンデションラボ 佐々木 阿悠佳 氏 イーセップ(株) 澤村 健一 氏	京都府ものづくり振興課 (公財)京都産業21 (株)けいはんな
7月4日	京都大学宇治キャンパス産学交流会	Web	1	75	75	京都大学 エネルギー理工学研究所 福垣 滋 氏・小島 崇寛 氏	京都大学宇治キャンパス産学交流企業連絡会 (公財)京都産業21 京都大学エネルギー理工学研究所 京都やましろ企業オンリーワン倶楽部 宇治市
9月29日	京都大学宇治キャンパス産学交流会	京都大学 宇治キャンパス	1	46	-	京都大学 生存圏研究所 中川 貴文 氏 田嶋 寿弥子 氏	京都大学宇治キャンパス産学交流企業連絡会 (公財)京都産業21 京都大学生存圏研究所 京都やましろ企業オンリーワン倶楽部 宇治市
12月12日	京都大学宇治キャンパス産学交流会	京都大学 宇治キャンパス	1	39	-	京都大学 防災研究所 西嶋 一敏 氏 角 哲也 氏	京都大学宇治キャンパス産学交流企業連絡会 (公財)京都産業21 京都大学防災研究所 京都やましろ企業オンリーワン倶楽部 宇治市
2月27日,28日	京都大学宇治キャンパス産学交流会 (学際統合物質科学研究機構(IRGCS)成果 報告会・産学WSとの共催)	京都大学 宇治キャンパス きはだホール Web	2	205	20	京都大学 渡辺 隆司 氏 斎藤 晋織 氏 他	IRGCS・京都大学宇治キャンパス産学交流企業連絡会 (公財)京都産業21 京都大学化学研究所 京都やましろ企業オンリーワン倶楽部 宇治市

依頼試験手数料・機械器具貸付料の特例措置について

◆ 料金体系

依頼試験の手数料及び機械器具の貸付料については、京都府手数料徴収条例及び京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則により定めておりますが、以下のとおり、特例措置を実施しております。

○ 依頼試験等の申込みを行う事業所の所在地

京都府内 ¹⁾ 中小企業者	京都府内 中小企業者以外	関西広域連合内 ²⁾	その他の都道府県 ³⁾
基本額から 2割減額	基本額	基本額	基本額の 5割増し

※ただし、京都府内に本社（主たる事務所又は事業所）がある場合は、京都府内事業所からの申し込みとして取り扱います。

例：本社が京都府内にある場合、滋賀県の工場からの申込みでも、京都府内の事業所からの申込みとして取り扱います。
中小企業であれば、料金は基本額から2割減額になります。

1) 京都府内中小企業者

京都府内中小企業者の基本額から2割減額の料金は、令和9年3月31日までの限定措置です。

「中小企業者」とは・・・
「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定する中小企業者のことをいいます。
【製造業の場合】 資本金の額3億円以下又は従業員数300人以下

2) 関西広域連合域内企業

京都府外の企業については、基本額の5割増しの料金に設定しておりますが、関西広域連合域内企業は、割増料金なしの基本額でご利用いただけます。

対 象： 滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県の企業

3) その他の都道府県の企業

その他の都道府県の企業については、基本額の5割増しの料金に設定しておりますが、下記の試験等については、国から貸付けを受けた機器を使用しているため、割増料金なしの基本額でご利用いただけます。

対象依頼試験： ラマン分光（分光分析）、マイクロフォーカス X線CT（非破壊試験）
対象貸付機器： レーザーラマン顕微鏡、マイクロフォーカス X線CT

◆ 消費税及び地方消費税の取り扱いについて

消費税及び地方消費税については、以下のとおりです。

依頼試験手数料： 非課税取引となります。
機器貸付料： 消費税相当額を含みます。

依頼試験の項目一覧

<分析>

区分		単位	手数料 基本額 (円)	備考
大分類				
中分類	小分類			
化学分析				
食品	水分	1 成分	2,040	
	灰分	1 成分	2,040	
	粗たんぱく	1 成分	2,550	
	粗脂肪	1 成分	2,550	
	その他	1 成分	2,550	
金属・その他		1 成分	2,550	
分光分析				
赤外分光	定性(通常分析)	1 件	5,100	
	定性(顕微分析)	1 件	7,140	
I C P 発光分光	定性	1 件	16,320	
	定量	1 成分	2,550	
色差測定		1 件	2,040	
顕微紫外・可視・近赤外分光	定性	1 件	3,570	
	定量	1 件	3,570	
蛍光測定	定性	1 件	2,040	
ラマン分析	定性	1 件	6,320	※他府県割増適用外
分光エリプソメトリ		1 件	8,670	1 試料 1 時間まで
テラヘルツ非破壊検査		1 件	14,280	1 試料 1 時間まで
クロマト分析				
液体クロマトグラフ	定性	1 件	6,120	
	定量	1 件	7,140	
高速液体クロマトグラフ	定性	1 件	16,000	
	定量	1 件	20,000	
イオンクロマトグラフ	定性	1 件	5,400	
	定量	1 件	7,030	
液体クロマトグラフ質量分析	定性	1 件	9,380	
X線分析				
X線回折		1 件	5,100	
蛍光 X 線	定性	1 件	8,400	
	定量	1 成分	4,200	
残留応力測定		1 件	9,480	
熱分析				
示差熱	定性	1 件	5,100	
熱膨張		1 件	6,120	
熱重量		1 件	5,100	
示差走査熱量		1 件	5,100	
熱機械		1 件	5,100	
熱伝導率		1 件	11,220	
表面分析				
微小 X 線分析	X線像	1 成分	10,200	マッピング
	線分析	1 成分	10,200	
	点分析(定性)	1 件	16,320	
	成分増し	1 成分	2,040	
X線光電子分光分析	スペクトル分析	1 件	27,540	
	深さ方向分析加算(イオン銃)	1 件	10,200	1 時間ごとに
	深さ方向分析加算(ガラスクラスターイオン銃)	1 件	13,260	1 時間ごとに
	面分析加算	1 件	10,200	1 時間ごとに
オージェ電子分光分析	スペクトル分析	1 件	22,440	
	深さ分析加算	1 件	11,220	
	オージェ電子像加算	1 件	11,220	
	オージェ電子像成分増し	1 成分	5,610	
グロー放電発光分析	表面分析	1 件	3,870	
	深さ分析	1 件	7,650	
ナノサーチ複合型顕微鏡観察	レーザー顕微鏡観察	1 件	3,300	1 試料 1 時間まで
	レーザー+プローブ顕微鏡観察	1 件	6,500	1 試料 1 視野から 1 時間まで

依頼試験の項目一覧

<電気試験>

区分		単位	手数料 基本額 (円)	備考	
大分類	中分類				小分類
電気試験					
	絶縁抵抗測定	1件	1,530		
	オシログラフ波形観測	500MHz 以上	1,530		
		500MHz 未満	200		
	インピーダンスゲインフェイズ測定	1件	1,120		
	広範囲インピーダンス測定	1件	3,060		
	低抵抗率測定	1件	300		
EMC 測定					
	入力インパルス雑音試験	1件	3,260	2時間までごとに	
	シールド材特性試験	1件	4,280	1測定ごとに	
	静電気放電測定	1件	1,530	2時間までごとに	
	サージ免疫試験	1件	2,550	2時間までごとに	
	ファーストランジェントバースト試験	1件	2,550	2時間までごとに	
	伝導性雑音電磁界測定	1件	13,260	1測定ごとに	
	放射線雑音電磁界測定	1GHz まで	14,280	1測定ごとに	
		1GHz から 6GHz	16,320	1測定ごとに	
	伝導性電磁界免疫試験	1件	12,240	1測定ごとに	
	放射線電磁界免疫試験	1GHz まで	10,200	1測定ごとに	
		1GHz から 2.5GHz	11,220	1測定ごとに	
	低周波エミッション測定	1件	10,200	1測定ごとに	
	低周波免疫試験	1件	10,200	1測定ごとに	
	電磁波妨害評価試験(G-TEM)	エミッション測定	6,420	1測定ごとに	
		免疫試験	11,220	1測定ごとに	
光・マイクロ波・ミリ波測定					
	光コンポーネント測定	1件	5,610	1測定ごとに	
	マイクロ波・ミリ波ネットワーク測定	1件	6,120	1測定ごとに	
	光オシロスコープ測定	1件	2,140	1測定ごとに	
	光スペクトラム測定	1件	1,020	1測定ごとに	
	全光束測定	大型積分球使用	5,810	1測定ごとに	
		小型積分球使用	5,200	1測定ごとに	
	配光測定	可視光	6,830	1測定ごとに	
		近赤外光	6,630	1測定ごとに	

<精密測定>

区分		単位	手数料 基本額 (円)	備考	
大分類	中分類				小分類
寸法測定					
	角度測定	1件	1,220		
	長さ測定	内・外径	1,220		
		その他	1,220		
形状測定					
	真直度	1m未満	2,040		
	表面粗さ	二次元測定	2,950		
		三次元測定	11,220	50ラインまで	
		三次元測定(測定ライン加算)	2,240	10ラインごとに	
	輪郭形状	数値データ	5,300	1断面単位	
		二次元解析	4,080		
		三次元解析	11,220	50ラインまで	
		三次元解析(測定ライン加算)	2,240	10ラインごとに	
	真円度	1件	2,040		
	平面度	1件	3,160		
	円筒度	1件	3,260		
データ入力					
	CNC 三次元測定	1件	3,260	50点まで	
		入力点数増し	610	10点までごとに	

依頼試験の項目一覧

<材料試験>

区分		単位	手数料 基本額 (円)	備考
大分類	中分類			
	小分類			
強度試験				
引張		1 件	1,530	
	(耐力加算)	1 件	760	
	恒温槽仕様	1 件	3,060	
圧縮		1 件	1,530	
	恒温槽仕様	1 件	3,060	
曲げ		1 件	1,530	
	恒温槽仕様	1 件	3,060	
荷重		1 件	2,550	
	恒温槽仕様	1 件	4,180	
ねじり		1 件	1,530	
	恒温槽仕様	1 件	3,060	
疲労		1 件	9,890	1 試料 1 時間まで
	(時間加算)	1 件	4,890	1 時間までごとに加算
	恒温槽仕様	1 件	11,220	1 試料 1 時間まで
	恒温槽仕様(時間加算)	1 件	5,910	1 時間までごとに加算
硬さ試験				
ブリネル		1 件	1,530	
	硬さ分布加算	1 件	1,220	
ロックウェル		1 件	1,530	
	硬さ分布加算	1 件	1,220	
ビッカース		1 件	2,040	
	硬さ分布加算	1 件	1,220	
摩耗試験				
往復運動式		1 件	4,080	
動摩擦摩耗試験		1 件	4,080	
金属組織試験				
顕微鏡		1 件	3,060	
電子顕微鏡試験				
二次電子観察		1 件	8,160	
反射電子観察		1 件	8,160	
視野増し		1 件	1,220	
元素分析	定性	1 件	10,200	
非破壊試験				
X線透過(工業 X 線透視)		1 件	3,570	
マイクロフォーカス X 線 CT		1 件	8,160	1 測定ごとに ※他府県割増適用外

依頼試験の項目一覧

<その他>

区分		単位	手数料 基本額 (円)	備考
大分類				
中分類	小分類			
環境試験				
腐食試験(塩水噴霧)		1件	2,040	24時間まで
	時間超過	1件	660	24時間ごとに
腐食試験(複合サイクル)		1件	910	1時間までごとに
耐候性試験	キセノン耐候性試験	1件	1,930	1時間までごとに
	メタルハライド耐候性試験	1件	1,830	1時間までごとに
温湿度組合せ試験(800L)		1件	2,950	2時間まで
	時間超過	1件	1,220	1時間までごとに
温湿度組合せ試験(300L)		1件	2,850	2時間まで
	時間超過	1件	1,220	1時間までごとに
温度組合せ試験(60L)		1件	1,220	2時間まで
	時間超過	1件	510	1時間までごとに
ヒートショック試験		1件	2,600	1時間までごとに
理化学試験				
金属顕微鏡によるめっきの厚さ測定		1件	3,060	
熱特性の測定		1件	4,080	
電磁法による膜厚測定		1件	1,020	
渦電流法による膜厚測定		1件	1,020	
蛍光 X 線による膜厚測定		1件	2,040	
薄膜付着強度試験		1件	3,060	
粒子径分布測定(バッチ式セル測定)		1件	1,930	
微生物試験				
培養		1件	2,550	
食品物性測定				
テクスチュロメーターによる測定		1件	1,530	
レオメーターによる測定		1件	1,530	
食品水分活性の測定		1件	1,020	
食品乾燥試験				
噴霧乾燥試験		1件	3,770	450g までごとに
凍結乾燥試験		1件	3,770	450g までごとに
その他		1件	3,770	450g までごとに
食品加工試験				
食品加圧試験		1件	1,120	
積層造形				
		1件	7,650	1時間までごとに
試料調整				
試料埋込み		1件	1,020	
試料切断		1件	1,020	
ナノサーチ複合型顕微鏡観察	回転式マイクローム加工	1件	10,000	1 試料 1 時間まで 1 件とは 1 試料単位とする

ご利用いただける機器一覧（本所）

<精密測定検査用>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
CNC三次元座標測定機	LeitzPMM-C12.10.7	HexagonMetrology GmbH	測定範囲：X = 1,200mm、Y = 1,000mm、Z = 700mm 空間精度：(0.6 + L/800)μm [L：測定長さmm] プロービング精度 = 0.6μm スキャニング精度 = 1.5μm/45秒	2011	基盤技術課	依頼試験のみ	複雑形状部品の精密計測
曲面微細形状測定システム(接触式測定)	フォームタリサーフ PGI 1200	アメテックス(株)テラーホブソン事業部	測定範囲：X = 120mm、Y = 100mm、Z = 12.5mm 測定分解能：0.8nm(Z方向) システムノイズ：2nm (Rq)以下	2014		4,480	表面粗さ・輪郭形状の測定
曲面微細形状測定システム(非接触式測定)	VR-3200	キーエンス	観察測定範囲：24×18mm ~ 1.9×14mm(連結可能) 電動 XY ステージ(移動量：184mm×88mm)			1,120	表面粗さ・輪郭形状の測定
レーザプローブ式非接触三次元測定装置	NH-3SP	三鷹光器	測定範囲 X, Y: 150mm、Z: 10mm 測定分解能 X, Y: 0.01μm、Z: 0.001μm 測定精度 X, Y: 0.5+2.5L/1,000μm、Z: 0.1+0.3L/10μm [L: 測定長さmm]	2009		3,770	微細部品の非接触での形状観察・評価
精密真円度・円筒形状測定機	タリロンド 595	アメテックス(株)テラーホブソン事業部	最大測定径：φ350mm 外周面最大測定高さ：500mm 内周面最大測定深さ：160mm 回転精度： (0.01 + 3H/10,000) μm [H：測定高さmm] ゲージ分解能： ±1mm 範囲/0.008μm、 ±0.04mm 範囲/0.0003μm 積載荷重：40kg	2013		5,610	精密部品の真円度・真直度測定
画像測定機	Smart ScopeVantage 600	O G P	測定範囲： X=450mm、Y=610mm、Z=300mm 測定精度【画像処理計測時】： XY U2=(1.5+4L/1,000)μm Z U1=(2.5+5L/1,000)μm [L：測定長さmm] 倍率：33.0~357倍(20インチ液晶画面上) 測定プローブ：画像プローブ(CCDカメラ)、レーザプローブ、接触式プローブ	2007		4,480	精密部品の光学測定
投影機	VS-300	神港精機	測定倍率：100倍、50倍、20倍、10倍、5倍 作動範囲：100mm×50mm(マグネスケール付) スクリーンのサイズ：φ300mm	1989	250	光学形状測定	

<材料試験用（その1）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
万能材料試験機	UCT-25T	オリエンテック	最大荷重：250kN	1989	基盤技術課	1,930	材料強度試験(引張・圧縮・荷重)
	UH-1000kNI	島津製作所	最大荷重：1000kN	2010		3,060	
	E10000LT	インストロン	引張/圧縮 ±10kN ねじり ±100Nm	2014		4,890	材料の疲労強度試験 部品の耐久性評価
			恒温槽仕様 温度範囲 -30~200℃			5,910	
	68TM-30E2F2	インストロン	最大荷重：30kN	2021		3,700	材料強度試験(引張・圧縮・3点曲げ)
			恒温槽仕様 温度範囲 -40~250℃			5,100	
接触式伸び計、非接触式ビデオ伸び計	850 ※加算						
万能材料試験機用3D-DIC	VIC-3D	Correlated Solutions	計測範囲：50X50~500X500mm	2021	1,300	非接触3次元での変形計測、ひずみ解析	
万能材料試験機用ハイスピードカメラ	FASTCAM Nova S6	フォトロン	最高撮影速度：6,400fps(1024X1024画素時) 800,000fps(128X16画素時)・	2021	1,500	破壊や破談の瞬間映像撮影	
計装化シャルピー衝撃試験機	CHARPAC	米倉製作所	秤量 49 J	1996	450	材料の靱性測定	
ナノインデンテーション試験機	ENT-2100	エリオニクス	荷重範囲：5μN~100mN 変位計測範囲：~50μm 試料サイズ：直径50mm×厚さ10mm(最大) その他： バーコピッチ圧子、球状圧子 R100μm、 平面圧子 □20、□100μm	2013	1,830	蒸着・塗装・めっき・DLC等 薄膜の硬さ物性評価	

ご利用いただける機器一覧（本所）

<材料試験用（その2）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
マイクロピカース 硬さ試験機	HMV2000AD	島津製作所	試験荷重： 0.049(5gf)～19.6N(2000gf)までの11段階 モニター表示による自動測定 曲面自動補正機能付き	1997	基盤 技術課	250	金属の微小部硬さ測定
デジタルロックウェル 硬さ試験機	ARD 型	アカシ	圧子：ダイヤモンド・超硬球	1980		200	ロックウェル硬さの測定
マイクロフォーカス X線CT	TOSCANCSR- 32300?FD	東芝ITコントロールシ テム	X線発生器：電圧230kV／焦点サイズ：4μm 検出器：8インチフラットパネルディテクタ 搭載可能サイズ：Φ320×H300mm／15kg 最大スキャンエリア：Φ260×300mm 高画質が得られるフラットパネルディテクタを搭載 空間分解能：5μm	2014	応用 技術課	4,080	マイクロフォーカスX線 CT試験 ※他府県割増適用外
X線応力解析装置	MSF-2M	理学電機	2θ測角範囲：140°～170°	1989	基盤 技術課	1,530	金属材料の残留応力測定
熱膨張記録計	DL-7000H	真空理工	高温型、赤外線イメージ炉	1989		910	材料の熱膨張測定
広範囲荷重摩耗 試験機	NUS-ISO-3	スガ試験機	往復速度：毎分40回 摩耗面積：30×12mm 摩耗輪寸法：直径50mm 幅12mm 荷重範囲：0.98～29.42N±0.05N 試験片寸法：最小30×50mm～最大70×300mm 厚さ最大4mm	1994	応用 技術課	100	往復運動方式による 摩耗試験
回転動摩擦摩耗 試験機	TR I-S-500NP	高千穂精機	回転数：30～3000rpm 押付力：200～5000N ドライ、ウエット	1999	基盤 技術課	1,020	摩擦・摩耗物性の評価
エレマ電気炉	KD-10ST	ロベット・コバタ電気工業	15kW	1975		350	金属の加熱

<電気試験用（その1）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
電磁波妨害評価 試験装置(G-TEM) (エミッション測定)	GTEM 750,N9010A- 507,A009K251- 5757R,A080M1	TESEQ,Keysight Technologies,アールア ンドケーなど	エミッション測定 放射性エミッション測定 30MHz～6GHz 雑音端子電圧測定 9kHz～30MHz 妨害電力測定 30MHz～300MHz	2016	応用 技術課	3,160	製品から放出される 電磁ノイズの測定
電磁波妨害評価 試験装置(G-TEM) (イミュニティ試験)	02- 5757R,GA701M 282-4850R- LCA など		イミュニティ試験 放射性イミュニティ試験 100kHz～1GHz 200V/m まで 80MHz～2.7GHz 10V/m まで BCI法イミュニティ試験 1MHz～1GHz 200mA まで 伝導性イミュニティ試験 150kHz～80MHz?10V まで			5,710	製品へ電磁ノイズを印加する 耐性試験
サンプリング オシロスコープ (86100D)	86100D	アジレントテクノロジー	測定範囲 光：DC～65GHz 電気：DC～80GHzにおける時間応答特性 TDRによる線路インピーダンス(シングルエンド、差動線 路)特性	2013		2,340	光・マイクロ波の線路評価
ミックスドシグナル オシロスコープ	MSO70804	テクトロニス	周波数帯域：8GHz アナログチャンネル：4ch、デジタルチャンネル：16ch メモリ長さ：125M、 サンプリングレート：最大 25GS/s アイパターンチェック、ジッター成分解析が可能	2014		1,530	アナログ・デジタルの 電気信号波形の観測
オシロスコープ	MDO3054	テクトロニス	周波数帯域：500MHz アナログチャネル：4ch メモリ長さ：10M、サンプリングレート：最大 2.5GS/s スペクトラムアナライザの機能搭載(9kHz～500MHz)		200	アナログ電気波形（対時間 又は周波数）の観測	

ご利用いただける機器一覧（本所）

<電気試験用（その2）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
光コンポーネントアナライズシステム(N4375D)	N4375D	アジレントテクノロジー	・測定周波数範囲 0.01~26.5GHz ・4ポートSパラメータ測定 ・光ポート 波長 1310nm、1550nmとの併用によるO/E、E/O周波数特性評価	2013		5,610	マイクロ波帯での周波数特性評価、光デバイスの周波数特性評価
ベクトルネットワークアナライザ(ME7838A)	ME7838A	アンリツ	・測定周波数範囲 70kHz~110GHz ・2ポートSパラメータ測定 ・アンテナ近傍界測定/遠方界変換評価(18~110GHz) ・フリースペース法による透過/吸収特性(18~110GHz)			8,770	マイクロ波・ミリ波帯域での周波数特性評価、アンテナ指向特性評価、材料特性評価
光スペクトラムアナライザ(AQ6370C(Z))	AQ6370C(Z)	横河メータ&インスツルメンツ	・測定波長範囲 600~1,700nm ・光ファイバー入力(FCコネクタ) ・基準光源内蔵			610	発光スペクトル測定評価、光透過波長特性評価
電磁波シールド特性測定システム(N9000A)	N9000A	アジレントテクノロジー	・測定周波数範囲 9kHz~3GHz (KEC法では100kHz~1GHz) ・トラッキングジェネレータ内蔵(100kHz~3GHz) ・信号増幅器			510	電磁波のスペクトル測定評価
光学特性評価システム(大型積分球使用)	SR8-LED	システムロード社	・積分球による全光束測定(φ76インチ、φ10インチ) ・配光測定(最長光路12m、波長範囲:380nm~2500nm)	2015	応用技術課	5,810	照明器具の全光束測定
光学特性評価システム(小型積分球使用)						5,200	発光デバイスの全光束測定
光学特性評価システム(可視光配光ユニット使用)						5,400	光源の可視光域の配光測定
光学特性評価システム(近赤外光配光ユニット使用)						5,200	光源の可視光域・近赤外域の配光測定
低抵抗率計	ロレスター-GPMPV-T610	三菱化学アナリテック	測定範囲: $9.999 \times 10^{-3} \sim 9.999 \times 10^7 \Omega$ 測定方法: 直流4深針法	2011		150	電磁波シールド材などの抵抗材料の評価
光デバイス用自動光軸調整装置	U4224	駿河精機	光デバイスと入・受光ファイバーのXYZ軸と光軸方向の入射角θzの4軸自動調芯機能 光デバイスと入・受光ファイバーのθX、θYの手動2軸微調芯機能 調芯位置の変位・時間変動に対する受光量モニタ機能 調芯精度 XYZ軸: 0.1μm 入射角θXθYθZ: 0.1度 UV樹脂によるデバイスと光ファイバの固定機能	1998		1,020	光導波路デバイスとファイバー等の光軸調整
高精度マスクアライメント装置	MA-20K型	ミカサ	最大基板サイズ: φ4インチ、2mm アライメント精度: 1.2μm(20倍対物レンズ) マニピュレータ: X・Y±5mm、Z4mm 露光用タイマー: 積算光量カウンター式			1,120	光導波路デバイスの導波路と電極パターンの作成
超精密研磨機	1 超精密ラッピングポリシング装置(PM5MA-20K型) 2 ダイヤモンドデスクソ-(モデル15)	丸本ストリアル	試料径 3インチまで 表面あらさ 最大 0.2nm(平均)程度 平坦度 最大 1/10 ⁴ (直径3インチウエハ時)程度 平行度 最大 2秒角(2/3600度)程度 取り付け可能資料大きさ 25mm×10mm~20mm×6mm 端面研磨精度調整範囲 ±3.0° 切断可能試料径 3インチまで 切断可能試料厚み 最大 50mm程度			1,220	ウエハ表面と光ファイバー端面の研磨
真空蒸着装置	EBH-6	日本真空技術	真空排気装置: DP 加熱源: 抵抗加熱 試料: 固定式 10cm角まで	1981		660	薄膜作成
赤外線熱画像装置	TVS-200Mk II ST	日本アビオニクス	温度測定範囲: -20℃~2000℃ 探知波長帯: 3~5.4μm 最小検知温度差: 0.1℃(黒体温度30℃) 温度測定精度: ±0.4℃ 検出器冷却方式: ターリングクーラー冷却 測定距離 20cm~∞ 測定視野角 15°(水平)×10°(垂直) フレームタイム: 30フレーム/s	1996	企画連携課	1,830	あらゆる物体の表面温度分布状況の測定

ご利用いただける機器一覧（本所）

<顕微鏡及び試料作製装置>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
倒立型金属顕微鏡	GX51/DP72	オリンパス	明視野 / 暗視野 / 微分干渉 / 簡易偏光 ×5, ×10, ×20, ×50, ×100 ×10 / 視野数 22 1280 万画素 BMP / TIFF / JPEG / JPEG2000 / AVI / PNG / VSI / PSD 鋳鉄解析(黒鉛球状化率、フェライト / パーライト率)、 粒子解析	2010	基盤 技術課	860	金属組織の観察
分析型 走査電子顕微鏡 (観察のみ)	JSM-7100F	日本電子	電子銃：ショットキー 対物レンズ：アウトレンズ型 表示倍率：×10～1,000,000 加速電圧：0.2kV～30kV 照射電流：数 pA～200nA 次電子分解能：1.2nm(30kV) 3.0nm(1.0kV) 最大試料寸法：100mmΦ×40mm t 試料ステージ：X-70mm Y-50mm Z-3～41mm 傾斜 -5～70° 回転 360° 元素分析(EDS)：検出元素(Be～U) 定性・定量・マッピング機能	2014		4,380	各種材料の微細構造の 高倍率観察及び元素分析
分析型 走査電子顕微鏡 (観察+元素分析)						5,610	
走査電子顕微鏡	JSM-6701F	日本電子	電子銃：冷陰極電界放出形電子銃 二次電子像分解能：1nm(15kV) 2.2nm(1kV) 反射電子像分解能：3nm(15kV) 表示倍率：25～650,000倍 加速電圧：0.5～30kV 試料ステージ：5軸モーター駆動ステージ X-Y：70×50mm、回転：360° 作動距離：1.5～25mm、傾斜：-5～+60°	2006		3,360	各種材料の微細構造の 高倍率観察
ナノサーチ複合型顕微鏡 (レーザー顕微鏡)	SFT-4500	島津製作所	レーザー顕微鏡部 (LSM) 光源：405nm 半導体レーザー 総合倍率：108～17,280倍 Z軸最大ストローク：76mm XYステージ：100×100mm プローブ顕微鏡部 (SPM) 光源：659nm 半導体レーザー 変位検出系：光てこ方式 最大走査範囲：X-Y：100×100μm Z：25μm 動作モード：コンタクト、ダイナミック、位相、電流、 表面電位 (KFM)、磁気力 (MFM)	2019	応用 技術課	3,300	数十 nm の段差計測、試料 表面の粗さ測定、複数のパターンの 形状解析、試料の物性解析など ・レーザー顕微鏡による広域 形状観察 ・プローブ顕微鏡による精密 形状観察 ・物性解析（位相変化による 硬さ評価、磁気情報、電 流分布、表面電位）
ナノサーチ複合型顕微鏡 (レーザー+プローブ顕 微鏡)						6,500	
ナノサーチ複合型顕微鏡 (試料調整) ※1						2,000	
モニタリングシステム	KH-2200	ビジネスリンクス	撮影素子：H570×V485 解像度：H360本以上、V350本以上 S/N：46dB 色温度：3100°K(MAX) カラービデオプリンター：プリント方式：昇華熱転写型 プリント画素数：720×468 プリント階調：3原色 256	1990		510	光軸可変実体観察
精密ダイヤモンド バンドソー	BS-300CL	メイワフォーシス	バンド厚さ：200μm	2014	基盤 技術課	1,020	分析試料の前加工

※1 切削刃は、機器借受者が持参してください。

<分析用（その1）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
波長分散型蛍光 X 線 分析装置	ZSX PrimusIV	リガク	定性分析、定量分析、薄膜分析、微小部分分析、マッ ピング分析が可能 測定範囲：Be～Cm 試料サイズ：最大φ50mm×30mm(h) (試料ホルダ ーに設置可能なもの)	2022	基盤 技術課	5,600	工業材料中の元素の定性 分析及び定量分析
ハンドヘルド蛍光 X 線 分析装置	NitonXL2-Plus	Thermo Fisher Scientific	切断が困難な大型金属試料などの分析が可能 測定範囲：Mg～Bi 測定径：φ8mm	2022		1,000	工業材料中の元素の定性 分析

ご利用いただける機器一覧（本所）

<分析用（その2）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
X線回折装置	RINT-Ultima III	リガク	集中法、平行ビーム法、薄膜斜入射、極点図、X線小角散乱の各測定に対応 Cu管球(40kV,40mA) 測角範囲：0°～130°(2θ)	2004	応用技術課	3,970	工業材料の結晶解析
炭素硫黄分析装置	CS-844	LECO	高周波誘導加熱－酸素気流中燃焼－非拡散赤外吸収法 測定範囲：炭素：0.6ppm～6.0% 硫黄：0.6ppm～6.0%(いずれも試料量は1g程度)	2011	基盤技術課	2,550	金属材料中の炭素及び硫黄の定量分析
ICP発光分光分析装置	SPS3100(24HV UV)	エスアイアイ・ナノテクノロジー	シーケンシャル型(2チャンネルタイプ) 検出下限値：10ppb以下(鉛) 波長範囲：130～770nm 塩素(134.724nm)からカリウム(766.491nm)までの元素が測定可能	2008	基盤技術課	依頼試験のみ	金属等に含まれる元素の定性分析・定量分析
フーリエ変換赤外分光光度計 (FT-IR)	IRPrestige-21	島津製作所	分解能：0.5cm ⁻¹ スペクトル波数：4000～400cm ⁻¹			2,650	有機化合物の定性分析・定量分析
レーザーラマン顕微鏡	RAMAN touch	ナノフoton	レーザー波長：532nm、785nm 対物レンズ：5、10、20、50、100倍 回折格子：300、600、1200gr/mm 検出器：電子冷却 CCD(1340×400画素)	2013	応用技術課	2,040	有機・無機化合物の定性分析 ※他府県割増適用外
分光エリプソメータ	UVSEL2	堀場製作所	光源 150Wキセノンランプ 波長範囲 190～2100nm 分光器・検出器 ・FUV-Vis：ダブルモノクロメータ・PMT検出器 ・NIR：シングルモノクロメータ・InGaAs検出器 ゴニオメータ 35～90° 試料ステージ 200×200×H30mm 最少スポットサイズ 35×85μm (70°)	2017	応用技術課	8,670	薄膜材料の光学特性評価
テラヘルツ非破壊検査装置	TAS7500TS	アドバンテスト	測定周波数範囲 分光測定：0.5～7THz 分光イメージング測定：0.1～4THz 測定モード 分光測定：透過、反射、ATR 分光イメージング測定： 透過、反射 (150mm×150mm) SN比 分光測定：57dB以上 分光イメージング測定：60dB以上 スキャンレート 16ms、8ms、1ms ホルダ制御温度範囲 室温～300℃ (透過測定のみ)	2018	基盤技術課	10,200	材料の異方性評価、異物観察、膜厚測定
顕微紫外可視近赤外分光光度計	MSV-5200 DGK	日本分光	測定：透過測定、反射測定 波長範囲：200～2700nm 試料ステージ：移動範囲：X78mm、Y52mm、Z25mm カセグレン鏡：16倍、32倍 対物レンズ：10倍、20倍、50倍 測定アパーチャ径：Φ10μm～Φ200μm(16倍カセグレン鏡) Φ5μm～Φ100μm(32倍カセグレン鏡)	2014	応用技術課	3,570	材料の微小部位の分光分析
分光蛍光光度計	F-7000	日立ハイテクノロジーズ	光源：150Wキセノンランプ 測定波長範囲：200～750nm及び0次光 感度：S/N800以上(RMS) S/N250以上(Peak to Peak) 試料形態：液体・粉体・フィルム等 3次元測定・時間変化測定が可能	2013	基盤技術課	610	液体・粉体・フィルム等の蛍光測定
蛍光マイクロプレートリーダー	SH-9000Lab	コロナ電機	上方蛍光測定および下方蛍光測定を選択可能 ダブルモノクロメータ方式で200～900nmから最適な励起・蛍光波長での測定可能 測定間隔・測定回数が設定可能 6～384ウェルプレートに対応 簡単操作でエクセル形式のレポート出力		応用技術課	810	マイクロプレート上の液体サンプルの蛍光測定
測色色差計	SQ2000	日本電色工業	測色範囲：380nm～780nm(10nm間隔) 特徴：正反射光の受光可能、拡散反射光のみの測定可能 出力：Lab ΔLab ΔE, L*a*b*, ΔL*a*b*, E*, YI W, WB, ΔYI ΔW ΔWB XYZ xy, 反射率など	2001	基盤技術課	300	材料・塗装面等の色度の測定

ご利用いただける機器一覧（本所）

<分析用（その3）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
分光蛍光光度計	F-7000	日立ハイテクノロジーズ	光源：150Wキセノンランプ 測定波長範囲：200～750nm 及び 0 次光 感度：S/N800 以上(RMS) S/N250 以上(Peak to Peak) 試料形態：液体・粉体・フィルム等 3次元測定・時間変化測定が可能	2013	基盤技術課	610	液体・粉体・フィルム等の蛍光測定
蛍光マイクロプレートリーダー	SH-9000Lab	コロナ電機	上方蛍光測定および下方蛍光測定を選択可能 ダブルモノクロメータ方式で 200～900nm から最適な 励起・蛍光波長での測定可能 測定間隔・測定回数が設定可能 6～384 ウェルプレートに対応 簡単操作でエクセル形式のレポート出力		応用技術課	810	マイクロプレート上の液体サンプルの蛍光測定
測色色差計	SQ2000	日本電色工業	測色範囲：380nm～780nm(10nm 間隔) 特徴：正反射光の受光可能、拡散反射光のみの測定可能 出力：Lab ΔLab ΔE, L*a*b*, ΔL*a*b*,E*,YI W, WB, ΔYI ΔW ΔWB XYZ xy, 反射率など	2001	基盤技術課	300	材料・塗装面等の色度の測定
ガスクロマトグラフ	GC-17A	島津製作所	キャピラリーカラム専用タイプ 検出器：水素炎イオン化検出器	1996	応用技術課	560	食品中の香気成分等の分析
液体クロマトグラフ	Prominence	島津製作所	高圧・グラジエントタイプ 検出器：紫外可視、蛍光検出器	2005		910	食品中のアミノ酸等の分析
高速液体クロマトグラフ	Nexera XR	島津製作所	送液ポンプ：流量設定範囲 0.0001～10mL/min オートサンブラ：注入量設定範囲 0.1～50μL カラムオープン：室温 -10～85℃ 検出器：蛍光、電気伝導度、示差屈折率、 フォトダイオードアレイ	2022		3,800	栄養成分、残留農薬、香粧品成分、化成品添加物、水道水質、環境汚染物質等の分析
飛行時間型液体クロマトグラフ質量分析装置(LC-TOF/MS)	micrOTOF2-kp	ブルカー・ダルトニクス	イオン化法：ESI もしくは APCI 質量範囲：50 ～ 20,000 m/z 質量分解能：16,500 FWHM 以上	2011		4,890	食品等に含まれる成分の組成式（元素組成）の推定と同定
イオン分析計	DionexICS-1100	サーモフィッシャーサイエンティフィック	ポンプ：ダブルブランチ方式 インジェクター：サンプルループ方式(1μL) カラム：陰・陽イオン分析用カラム付け替え方式 検出器：電気伝導度検出器(サブレッサ方式)	2014	応用技術課	960	ポリマーや金属表面の残留汚染物質又はイオン成分の分析
電子線マイクロアナライザ (EPMA) (WDS 又は EDS)	JXA-8200	日本電子	電子銃 高輝度 LaB6 及びタングステンの切り替え可 最大試料寸法 100×100×50mm 加圧電圧 0.2～30KV 照射電流範囲 10 ⁻¹² ～10 ⁻⁵ A 二次電子像分解能 5nm(LaB6) 走査倍率 X40～300,000 透過電子検出器 カソードルミネセンスシステム 波長分散法(WDS) 分析元素範囲 ホウ素(B)からウラン(U)まで 分光器数 5チャンネル	2005	応用技術課	5,200	材料の微小部分分析
電子線マイクロアナライザ (EPMA) (WDS 及び EDS)			5,810				
電子線マイクロアナライザ (EPMA) (WDS カラーマッピングを含む)			6,520				
電子線マイクロアナライザ (EPMA) (全仕様)			7,240				
			分析元素範囲 ホウ素(B)からウラン(U)まで エネルギー分散法(EDS) 分析元素範囲 ホウ素(B)からウラン(U)まで エネルギー分解能 133eV 以下 定性分析、半定量分析、定量分析(ZAF 法、検量線法、Bence & Albee 法、Phi - Rho - Z 法、薄膜定量)、状態分析、線分析、面分析(任意形状マップ、任意曲面マップ)、相分析、薄膜定量分析、波形分離ソフト、電子線侵入領域表示ソフト				

ご利用いただける機器一覧（本所）

<分析用（その4）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
FE オージェ電子分光分析装置(全仕様)	PHI-700	アルバック・ファイ	フィールドエミッション(FE)タイプ電子銃 同軸円筒鏡型電子分光器(CMA) 中和機能付 アルゴンイオン銃 アコースティックエンクロージャ	2009		11,220	各種材料の 微小部表面分析
FE オージェ電子分光分析装置(イオン銃不使用)						8,160	
X線光電子分光分析装置(イオン銃)	PHI5000VersaProbe2	アルバック・ファイ	X線源：モノクロメータ(AI アノード、デュアルアノード(Mg/Al)) X線ビーム径：φ10~200μm X線スキャン範囲：□1.4mm×1.4mm 最高エネルギー分解能：半値幅 0.57eV(Ag3d) Ar イオン銃加速電圧：0.2~5kV Ar ガスクラスターイオン銃加速電圧：1~20 kV 最大試料サイズ：φ60mm(高さ8mm)以下	2014	応用技術課	10,200	固体表面微小(φ200μm範囲)の元素組成及び化学結合状態分析
X線光電子分光分析装置(ガスクラスターイオン銃)						13,260	
グロー放電発光分析装置	GD Profiler 2	堀場製作所	測定元素：ポリクロメーター (H, Li, B, C, N, O, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca, Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, In, Sn, W, Au, Pb) モノクロメーター(H~U、1元素)測定エリア： 4mmφ(標準)、2mmφ、7mmφ 試料サイズ：10mm 深さ分解能：数 nm 測定深さ：数 nm~100μm(最大)			7,650	各種材料の元素の 深さ方向分析
粒子径分布測定装置	SALD-2300	島津製作所	測定原理：レーザ回折・散乱法 測定範囲：0.017~400μm	2013		560	粉体の粒度分布特性の測定
示差熱・熱重量測定装置	DTG-60H	島津製作所	温度範囲：室温~1500℃ 質量測定範囲：±500mg 示差熱測定範囲：±1000μV 重量読み取り限界：0.001mg 秤量：風袋込み 1g	2014	基盤技術課	660	材料の示差熱・熱重量の測定
示差走査熱量計	DSC-60Plus	島津製作所	温度範囲：-140~600℃ 熱流量検出範囲：±150mW			860	材料の示差走査熱量の測定
熱機械分析装置	TMA-60	島津製作所	温度範囲：室温~1000℃(膨張測定時) -150~600℃(冷却加熱炉使用時) 試料寸法：直径 8×20mm 以下 試料への荷重：0~±5N			1,120	材料の熱機械特性の測定
熱伝導率測定装置	LFA467	ネッチ・ジャパン	温度範囲：室温~500℃ 熱拡散率測定範囲：0.01×1000mm ² /s 熱伝導率測定装置：<0.1~2000W/(mK) 試料寸法：10×10mm			2,140	材料の熱伝導率の測定
自動ボンベ熱量計	1013-H	吉田製作所	測定範囲：1000~8000cal ボンベ：18-8 ステンレス(SUS304)	1989	応用技術課	300	カロリー（熱量）測定

<表面処理・環境試験用（その1）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
蛍光 X線膜厚計	EA6000VX	日立ハイテクサイエンス	測定元素：Na(原子番号 11)~U(原子番号 92) 線源：Rh ターゲット 管電圧最大 50 kV 管電流最大 1000μA 検出器：マルチカソード Si 半導体検出器 測定領域：0.2、0.5、1.2、3.0mm□ 測定機能：検査線モードによる単層、二層、合金膜厚測定 薄膜 FP モードによる最大 4 層の膜厚測定 定性分析・マッピング測定 試料最大サイズ： 250(幅)×200(奥行)×150(高)mm	2014	応用技術課	2,040	めっき等金属皮膜の厚さ測定
表面物性試験装置	CSR-2000	レスカ	JISR-3255 に準拠したマイクロクラッチ法による測定 印加荷重範囲：1mN から 1N 圧子励振振動数：45Hz 圧子励振幅：5・10・20・40・50・80・100μm 圧子形状：R5・15・25・50・100μm			3,060	薄膜付着強度試験

ご利用いただける機器一覧（本所）

＜表面処理・環境試験用（その2）＞

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
ポテンショスタット	HZ-5000	北斗電工	・最大出力電圧 ±30V ・最大出力電流 ±1A	2008	基盤 技術課	250	材料の耐食性評価、 湿式製膜特性評価
塩水噴霧試験機	STP-90V-4	スガ試験機	試験槽内温度：35±2℃ 腐食液：5%食塩水	1989		依頼 試験のみ	塩水による錆発生試験
複合サイクル 腐食試験機	CYP-90	スガ試験機	塩水噴霧：35～50±1℃ 噴霧液 5%中性塩 乾 燥：外気温度+10℃～70±1℃ 湿度 25±5%rh(60℃に於いて) 湿 潤：外気温度+10℃～50±1℃ 湿度 60～95±5%rh(50℃に於いて) 外気導入：温湿度制御なし 試験室サイズ：900(幅)×600(奥行)×500(高)mm 試料枚数：48 枚(150×70×1mm) 試料取付角度：垂直に対して15°または20°	2013		依頼 試験のみ	材料の腐食環境試験
耐候性評価システム (キセノンランプ)	XER-W75	岩崎電気	光源：キセノンランプ 最大放射照度：48～180W/m ² 照射時温度：50～95℃ 照射時湿度：40～80%rh 有効照射面積：54 片(70mm×150mm)	2014		1,630	キセノンランプ方式各種材料 の促進耐候性評価
耐候性評価システム (メタルハライドランプ)	SUV-W161	岩崎電気	光源：メタルハライドランプ 最大放射照度：1500W/m ² 照射時温度：50～85℃ 照射時湿度：40～70%rh 有効照射面積：190mm×422mm			1,530	メタルハライドランプ方式各種 材料の促進耐候性評価
超低温恒温器	MC-811P	エスベック	-85℃～+180℃ 試験室寸法：400×400×400mm 温度上昇時間：+20℃～+180℃まで約30分 温度下降時間：+20℃～-80℃まで約70分	2011	400	超低温での動作確認、 温度サイクル試験等	
温湿度サイクル 試験装置	PSL-2K	エスベック	温度：-70～+100℃ 湿度：20～98%RH 試験室サイズ： 600(幅)×600(奥行)×850(高)mm	2004	710	温度・湿度を固定あるいは 可変にしての耐環境試験	
冷熱衝撃試験装置	TSA-103ES-W	エスベック	温度範囲： (高) +60～+200℃ (低) -70℃～0℃ 試験室サイズ： 650(幅)×370(奥行)×460(高)mm	2020	2,200	急激な温度上昇・下降環境 下での耐環境試験	

＜微生物・食品試験用＞

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
テクスチュロメーター	GTX-2-IN	全研	そしゃくスピード：6回/分 及び 12回/分	1979	応用 技術課	560	食品の硬さ・もろさ・附着性 等の「そしゃく」に準じた物性 試験
レオメータ	NRM-2010J-CW	不動工業	測定荷重：0～98N 作動速度：2, 5, 6, 30cm/min			250	食品の圧縮・引っ張り応力 緩和・そしゃく試験
凍結乾燥機	FD-1	東京理化工機	トラップ冷却温度：-45℃ 除湿量：4L / 回	1987		200	食品等の凍結乾燥
噴霧乾燥機	SD-1000	東京理化工機	噴霧ノズル：二流体ノズル 水分蒸発量：最大1500mL/h (試料の種類・乾燥条件により時間当たりの処理量は 異なります。) 温度調節範囲：40～200℃	2014		400	飲料、液体調味料、その他 液体食品の噴霧乾燥
嫌気性培養装置	EAN-140	タイパエスベック	脱酸素触媒方式	1989		200	嫌気条件下での 微生物培養
超音波ホモジナイザー	Q500	Qsonica	最大出力：550W 周波数：20kHz	2015	150	微生物（細菌等）及び 組織等の破碎・ホモジナイズ	
リアルタイムPCR装置	Thermal CyclerDice RealTimeSystem 2	タカラバイオ	温度測定範囲：4.0～99.9℃ 同時測定サンプル数：96サンプル 検出方法：SYBR Green I 検出及びプローブ検出	2011	560	食品等含まれる 特定のDNAの定量分析	

ご利用いただける機器一覧（本所）

<映像・工芸技術用>

※貸付料基本額は 1 時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
アイマークレコーダー	EMR-V	ナック	視野：水平 30°60° 垂直 22.5°45°	1989	企画 連携課	760	人の目の注視点測定により感情変化等を解析
ホスト CG システム (基本システム)	ONYX	シリコングラフィックス	表示解像度：1280×1024 同時表示可能色：16777216 色			4,990	2次元・3次元画像処理によるデザイン開発、シミュレーション、プレゼンテーション、アニメーション映像制作 3Dゲームグラフィックス
ホスト CG システム (全仕様システム) 画像・映像の入出力機器を含む						7,030	2次元・3次元画像処理によるデザイン開発、シミュレーション、プレゼンテーション、アニメーション映像制作 3Dゲームグラフィックス
4K メモリーカムコーダー	PXW-Z100	ソニー	4K(4096×2160) フレームレート；60P(59.94p) 映像サンプリング処理；4:2:2 ビットレート；10bit 最大 600Mbps 映像記録方式；XQD カードスロット×2 XAVC 記録 放送業務用 4K カメラの規格と同じ記録方式に対応。 (32GB の XQD メモリーカード 1 枚で約 6 分間録画可能) ※追加記録用 XQD メモリや三脚等は申込者でご準備ください。	2015		100	4K 映像の撮影
サンドブラスター	SGK-3 型	不二製作所	加工範囲：600×500×600mm	1985		150	金属の表面硬化処理及び木材、金属、ガラス等の彫刻、研磨

<造形・試作用>

※貸付料基本額は 1 時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
高速三次元成形機 (樹脂粉末積層 3 D プリンタ)	RaFaEl 300F	アスペクト	作成方法 粉末焼結法による積層造形 有効造形サイズ 300mm × 300mm × 400mm 実造形サイズ 290mm × 290mm × 370mm 積層ピッチ 0.08mm~0.20mm (標準 0.1mm) レーザー Fiber レーザ 出力 50W、ビーム径 0.17mm 走査速度 10m/sec、ジグザグ走査方式 造形材料 ナイロン 11(ASPEX-FPA 黒)	2013	基盤 技術課	7,030	3次元 CAD データからの立体モデルの作成
三次元スキャナ (本体)	FARO EdgeScanArm ES 9ft	ファロー	非接触式スキャナ部 <光切断方式> 精度：±35µm 繰返し精度：35µm (2σ) スキャンレンジ：80mm~165mm(測定深さ方向) スキャンレート：45,120 点/秒 接触式アーム部 <7 軸関節測定> 定点繰返し精度：29µm 測定精度 (二点間距離)：±41µm 測定範囲：2.7m	2014		1,730	3次元データの取得
三次元スキャナ (ソフトウェア)			PolyWoks Inspector Premium (検査) + Modeler Premium (データ編集) Materialise 3-matic STL (データ編集)			910	
3次元 CAD/CAE	SolidWorks	SolidWorks	SolidWorks (3次元 CAD)	2000		250	3次元 CAD データの作成・活用
	SolidWorks Simulation	SolidWorks	SolidWorks Simulation (CAE 構造解析)				

<精密測定検査用>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
CNC 三次元測定機	Crysta-ApexC9166	ミットヨ	測定範囲：905×1,605×600mm 指示誤差：(1.7+4L/1,000)μm (L：測定長さ) 画像測定用プローブを併用した非接触測定も可能	2007	中丹技術支援室	3,260	複雑形状部品の精密計測
表面粗さ・輪郭形状測定機	SV-C4000CNC	ミットヨ	測定範囲：X 200mm、Y 200mm、Z(表面粗さ)0.8mm、Z(輪郭形状)50mm 分解能：(輪郭形状)0.05μm Y軸テーブルを駆動しての三次元表面粗さ測定も可能			1,930	精密部品等の表面粗さ・輪郭形状の測定
携帯用表面粗さ計	SJ-301/0.75mN	ミットヨ	測定範囲：X軸 12.5mm、Z軸 350μm 測定力：0.75mN	2006		450	精密部品等の表面粗さ測定
レーザ顕微鏡	LEXT OLS3100	オリンパス	高さ測定範囲：10mm 最大試料寸法：150×100×100mm 平面分解能：0.12 μm 高さ分解能：0.01μm			2,140	微小な表面形状等の非接触精密計測・観察
三次元光学プロファイラー	NewView8300	ゼイゴ	垂直走査低コヒーレンス干渉法 垂直分解能 0.1nm 空間分解能 0.52μm	2017		3,770	
真円度・円筒形状測定機	RA-H5100CNC	ミットヨ	回転精度： (0.02+4H/10,000)μm (H：測定高さ) 最大測定径：φ356mm 最大測定高さ：550mm	2007		2,340	精密部品等の真円度・円筒度測定
定盤	グラブレード No.517-409	ミットヨ	寸法：1,000×1,000mm 等級：00 級	2006		150	精密測定機器の校正作業、精密部品の測定作業時の基準平面
チェックマスタ	HMC-1000H	ミットヨ	測定範囲：1,000mm			150	精密測定機器の校正
ハイトマスタ	HME-600DM	ミットヨ	測定範囲：10<H≦610mm			150	
ハイトゲージ	HDM-100AHD-30A,HS-30	ミットヨ	最大測定長：1,000mm、300mm			100	精密部品等の高さ測定
マイクロメータ	MDC-25MJ 他	ミットヨ	測定範囲：0～800mm		100	精密部品等の寸法測定	
内測マイクロメータ	HT-12ST 他	ミットヨ	測定範囲：2～1,300mm		100	精密部品等の内径測定	
セラミックブロックセット	BM3-112-K	ミットヨ	組数：112 個組 等級：K 級		350		
ゲージブロックセット	No.613802-013 他	ミットヨ	寸法：125、150、175、200、250、300mm 等級：K 級		200	精密測定機器の校正	
リングゲージ	No.177-146 他	ミットヨ	寸法：φ50、60、70、80、90、100、125、175、200、225、250、275、300mm		2007	150	

<機械加工用(その1)>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
旋盤 ※1	LEO-80A	テクノワシノ	ベッド上の振り：490mm 往復台上の振り：260mm センター間距離：800mm	2007	中丹技術支援室	910	機械部品等の切削加工
フライス盤 ※1	KGJP-55	牧野フライス製作所	移動量：X550 Y250 Z350mm 主軸回転数：130～2,200rpm (8段切換)			1,530	機械部品等の切削加工
小型旋盤 ※1	EB-10	エグロ	ベッド上の振り：266mm 切削台上の振り：140mm センター間距離：250mm			300	機械部品等の切削加工
タッピングボール盤 ※1	KRT-340R	キラ・コーポレーション	タッピング能力：M4～M10 (S45C) ドリリング能力：φ3～φ11mm (S45C)	2006		100	穴あけ・ネジ穴あけ
手動折り曲げ機	LD-414	盛光	加工板厚：2.0×1,220mm 口の開き：38mm			100	金属製板材の折り曲げ
鏡面ショット研磨機	SMAP II 型	東洋研磨材工業	開口部：260×350mm			560	研磨材による乾式研磨

※1 切削工具(旋削用チップ、エンドミル、ドリル刃、タップ等)は、機器借受者が持参してください。

<機械加工用 (その2)>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
電気溶接機	デジタル溶接機	松下溶接システム	溶接ヒューム回収装置付	2006	中丹技術支援室	1,530	ステンレス・鋼材の溶接
ベルト研磨機	FS-2N	淀川電機製作所	ベルト寸法：幅 100mm			200	金属等の研削
両頭グラインダ	FG-205T	淀川電機製作所	砥石寸法：205φ×19mm			150	
高速切断機	SK-1	昭和機械工業	砥石：305φmm			100	
帯ノコ盤	VZ-300	ワイエス工機	切断能力：高さ 200mm、奥行き 300mm 鋸刃速度：25～115 m/min			100	

<材料試験用>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
万能材料試験機 (250kN)	AG-250kNIS MO	島津製作所	最大荷重：250kN	2007	中丹技術支援室	3,670	材料強度試験 (引張・圧縮・曲げ・荷重)
万能材料試験機 (5kN)	AG-5kNIS	島津製作所	最大荷重：5kN			1,020	材料強度試験 (引張・圧縮・曲げ・荷重)
ひずみゲージ式センサ・アンプユニット	LU-100KE, LU-1TE, LU-10TE, AS-10HB, AS-100HA, PG-10KU, PG-100KU, DT20D, DPM-712B	共和電業	引張圧縮両用型ロードセル 3 種、 高応答小型加速度変換器 2 種、 圧力変換器 2 種、 変位変換器、 動ひずみ測定器	2006		200	ひずみゲージ式センサーにより荷重・圧力・変位の物理量を測定
ロックウェル硬さ試験機	ARK-600	ミットヨ	デジタル表示、自動(負荷、保持、除荷)			400	ロックウェル硬さの測定
マイクロピッカース硬さ試験機	FM-700	フューチュアテック	試験荷重：0.049(5gf)～19.6N(2000gf)までの11段階 モニター表示による自動測定 曲面自動補正機能付き			450	金属の微小部硬さの測定
簡易携帯硬さ試験機	エコーチップ硬さ試験機	プロセク	HL、HV、HB、HS、HRC、HRB、HRA		200	各種材料等の各種硬度測定	
反発式ポータブル硬さ試験機	HARDMATICHH-411	ミットヨ	最小試験面：22mmφ、 硬さ HL 値を基にピッカース、プリネル、ロックウェル C、ロックウェル B 等への換算可能	100	金属用硬度計		
マイクロフォーカス X 線透視装置	SMX3000micro	島津製作所	搭載可能サイズ：φ300、高さ 650mm 搭載可能サンプル質量：20kg 以下 X 線出力：130 kV	2007	3,870	アルミダイカストなどの内部欠陥の観察・検査	
真空定温乾燥器	DP43	ヤマト科学	温度：(室温+10℃)～200℃ 到達真空度：6.7×10 ⁻¹ Torr 以下 器内寸法：450×450×450 ^H mm	2006	350	各種材料の真空定温乾燥	
電気マッフル炉 ※2	FUM332PA	アドバンテック東洋	使用温度範囲：400～1,300℃ (常用最高温度 1,200℃) 温度分布精度：±5℃(1,100℃) 昇華時間：約 30 分(常温→1,100℃)		150	金属の焼き入れ・焼きなまし・焼成の他灰分試験・溶融点の測定	
赤外線サーモグラフィ (R500EX-Pro)	R500EX-Pro	日本アビオニクス	測定範囲 -40～2000℃ 温度精度 ±1℃(20～30℃) 画素数 1280×960 画素(超解像モード) 640×480 画素(通常モード) 2 倍望遠レンズ付き、P-Cリアルタイム転送(30Hz)	2017	560	物体の表面温度分布状況の測定	
FFT アナライザー	EDX-2000A	共和電業	最高サンプリング周波数： 200kHz (16CH 同時サンプリグ時) 周波数応答解析、トランキング解析	2006	400	各種装置の機械振動・回転振動等の測定・周波数解析	
振動計 ※3	VM-82 (ピックアップ：PV-57A)	リオン	測定範囲 加速度：0.002～20G (1Hz～5 kHz) 速度：0.3～1,000mm/s (3Hz～1 kHz) 変位：0.02～100mm (3～500Hz)		100	機械の振動状態の測定	
機械振動周波数分析システム	EDX-200A-1	共和電業	測定チャンネル数：最大 8ch サンプリング周波数：1Hz～100kHz 本体外形寸法：148(W)×53(H)×257(D)mm 本体質量：約 0.9kg	2014	300	金属材料の振動周波数特性等の解析	

※2 使用するガス等は、機器借受者が持参してください。

※3 乾電池等消耗品は、機器借受者が持参してください。

<電気試験用>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
シンクロスコープ (DL9040)	DL9040	横河電機	周波数帯域：500MHz 最高サンプリングレート：5G/s メモリ長：2.5MW 入力数：4ch	2006	中丹技術支援室	200	電気信号の波形観測・記録
データレコーダー	LX-10	ティアック	記録可能周波数：DC～40 kHz 入力：8ch、出力：8ch			200	電気信号の記録およびその再生
PIC マイコンデバッグ	MPLABICD2	マイクロチップ	フラッシュ型 PIC 用			100	PIC マイコンのデバッグ及びプログラムライター
ファンクションジェネレータ	SG-4105	岩通計測	出力可能波形・周波数 正弦波、方形波：10MHz～15MHz 三角波、パルス波、ランプ波：10MHz～100kHz			100	さまざまな周波数と波形をもった電気信号の生成
ユニバーサルカウンタ	SC-7206	岩通計測	測定周波数範囲：10MHz～2GHz(カップリング AC)			100	電気信号の周波数測定
直流安定化電源装置	PAN35-5A	菊水電子工業	出力電圧：0～35V 出力電流：0～5A			100	定電圧・定電流の直流電源装置
EMC 測定システム	GTEM750	シャフナー	供試体最大サイズ：62cm×62cm×49cm 放射エミッション測定：30MHz～3GHz 放射イミュニティ試験：80MHz～1GHz 伝導イミュニティ試験：150kHz～80MHz 雑音端子電圧測定：150kHz～30MHz 静電気試験	2007		3,570	GTEM セルを用いたエミッション測定・イミュニティ試験
インピーダンス・ゲインフェーズアナライザシステム	E4990A	キーサイト・テクノロジー	測定周波数範囲：20 Hz～120 MHz	2017		1,830	電子部品等のインピーダンス評価、誘電率・透磁率の材料定数測定
	ZGA5920	N F回路設計ブロック				910	低周波帯における電子部品等のインピーダンス評価、ゲイン・フェーズ測定

<顕微鏡及び試料作製装置 (その1) >

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
コンタミネーション解析システム	RH-2000-PC	ハイロックス	レンズ倍率：35～2,500倍 コンタミネーション解析機能 (ISO16232、NAS1638 及び VDA2015 に準拠した洗浄度評価) ろ過装置付き 自動テーブル(50mm×50mm) 2D 及び 3D において寸法計測及び粗さ解析	2017	中丹技術支援室	1,420	油分中に含まれる異物の大きさ・カウント
走査電子顕微鏡 (観察のみ)	JSM-IT300HR 及び JED-2300 Analysis Station Plus	日本電子	分解能 [高真空モード]1.5nm(30kV) [低真空モード]1.8nm (15kV) 倍率 5～600,000倍 元素分析(EDS) Be～U 定性・定量分析 元素マッピング機能付き 試料ステージ X:125,Y:100,Z:80mm 傾斜 -10～90度 回転 360度			3,460	各種試料の表面観察
走査電子顕微鏡 (観察+元素分析)						5,300	各種試料の表面観察及び元素分析
走査電子顕微鏡 (観察+結晶方位分析)						6,120	各種試料の表面観察及び結晶方位分析
走査電子顕微鏡 (観察+元素分析+結晶方位分析)						7,850	各種試料の表面観察、元素分析及び結晶方位分析
デジタルマイクロスコープ	KH7700	ハイロックス	倍率：6～3,500倍 斜視観察：25・35・45・55度	2007		810	工業部品・材料の拡大観察・解析
金属顕微鏡	TME200BD	ニコン	倍率：50、100、200、500、1000 明視野、暗視野	2006		250	金属組織の観察
実体顕微鏡	SMZ1000	ニコン	総合倍率：4～40倍		100	部品等の拡大観察	

<顕微鏡及び試料作製装置 (その2) >

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
クロスセクションポリッシャ	IB-19530CP	日本電子	イオン加速電圧 2~8kV ミリングスピード 500μm/h 自動スイング機能 ±30° 最大試料サイズ： 11mm(幅)×10mm(長さ)×2mm(厚さ) CCD カメラによる試料位置合わせ	2017	中丹技術 支援室	810	イオンビームを用いた 試料面の作製
金相試料作製装置	ラボプレス 1,テグラ ボール21,テグラフォ ース 3,テグラドーザ 1,デイスコム6	丸本ストラス	精密試料切断機、試料埋込機、半自動研磨機	2006		6,220	金相試料の作製
クライオミル	CryoMill	ヴァーダー・サイエントフ ィック	粉砕方法：衝撃力、摩擦力 試料投入サイズ：8mm 以下 投入試料量：最大 20ml 粉砕時間(通常)：10分/4分(冷却/粉砕) 粉砕モード：乾式、湿式、凍結 粉砕セット材質：ステンレス鋼	2020		450	試料の粉砕

<分析用 (その1) >

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
蛍光 X 線分析装置 (EDX-7000)	EDX-7000	島津製作所	検出元素 Na~U X線照射径 0.3, 1, 3, 5, 10mm 下方照射 CCD カメラによる試料画像観察機能有 液体(大気環境のみ) 及び粉体用容器付き	2017	中丹技術 支援室	1,730	各種材料中に含まれる 元素分析(定性・定量)
スパーク放電発光 分析装置	PDA-7000	島津製作所	検出元素及び測定範囲 C (0.003 ~ 4.0%), S i (0.002 ~ 4.0%), S (0.001 ~ 0.1%), P (0.001 ~ 0.5%), M n (0.002 ~ 2.0%) 他 ※括弧内は含有率 測定サイズ φ12mm~			2,750	鋳鉄、鉄鋼材料中の 元素分析(定性・定量)
X 線回折装置 II	XRD-6100	島津製作所	最大測定角範囲：-3~150° (2θ) 最小送り幅：0.002° (θ, 2θ) 繊維選択配向測定可能 カウンターモノクロメーター 装備	2007		1,630	各種工業材料の 結晶構造の解析
フーリエ変換 赤外分光光度計 (赤外顕微鏡付)	IRPrestige- 21AIM-8800	島津製作所	ビームスプリッタ：Ge 蒸着膜 KBr 検出器：DLATGS 検出器 波数範囲：7800~350 分解能：0.5cm ⁻¹ オートオーバーチャージ		2,650	主に有機物の同定と定量	
紫外・可視分光光度計	V-630	日本分光	ダブルビーム方式 波長範囲：190~1100nm スペクトルバンド幅：1.5nm 測定モード：Abs、%T	2006	150	各種材料の紫外・可視 スペクトル測定	
分光色差計	NF-333	日本電色工業	分光反射測定範囲：400~700nm 表色系：L*A*B*系他		100	各種材料の表面色の 測定	
分光蛍光光度計	F-7000	日立ハイテクノロジーズ	光源：150Wキセノンランプ 測定波長範囲：200~750nm 及び 0 次光 感度：S/N800 以上(RMS) S/N250 以上(Peak to Peak) 試料形態：液体・粉体・フィルム等 3 次元測定・時間変化測定が可能	2007	610	蛍光・りん光の測定による スペクトル分析・定量分析	

<分析用 (その2)>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
ガスクロマトグラフ質量分析装置 (オプションなし)	GCMS-QP2020NX EGA/PY-3030D HS-20Trap	島津製作所	GC-MS イオン化方式: E I 質量範囲: m/z1.5~1,090 最大スキャン速度: 20,000u/秒 液体オートサンプラー最大試料数: 150	2020		4,300	有機化合物の定性及び定量分析
ガスクロマトグラフ質量分析装置 (パイロライザー)			パイロライザー 温度制御範囲: 室温+10~1050℃ 温度安定性: ±0.1℃以内 インターフェイス温度: 40~450℃ オートサンプラー最大試料数: 48			6,000	
ガスクロマトグラフ質量分析装置 (ヘッドスペースサンプラー)			ヘッドスペースサンプラー 試料導入方式: サンプリングループ及びトラップ 最大試料数: 90 バイアルサイズ: 20mL、10mL 攪拌: 5段階 保温温度: 室温+10~300℃ トラップ冷却温度: -30~80℃ トラップ加熱温度: 0~350℃			5,200	
ガスクロマトグラフ質量分析装置 (ダイレクトインジェクション)			ダイレクトインジェクション 温度設定範囲: 室温~500℃			4,400	
液体クロマトグラフ	Prominence	島津製作所	高圧、グラジエントタイプ 検出器: 紫外可視、蛍光検出器	2006	中丹技術支援室	910	有機化合物の定性及び定量分析
アミノ酸分析装置	L-8900	日立ハイテクノロジーズ	カラム: 陽イオン交換カラム 反応試薬: ニヒドリン 検出波長: 570nm, 440nm	2007		2,850	アミノ酸の分析
示差走査熱量測定装置	DSC-60A	島津製作所	測定温度: 温度プログラム可能 液体窒素非使用時: 25~600℃ 液体窒素使用時: -130~500℃	2006		760	材料のDSC測定
細管式レオメータ	CFT-500D	島津製作所	分銅による定試験力押し出し式 試験圧力: 0.4903~49.03MPa 試験温度: (室温+20)~400℃			810	樹脂等材料の流動性評価
レーザー回折式粒度分布測定装置	SALD-2200	島津製作所	レーザー回折散乱法 測定範囲: 0.03~1000µm 有機溶媒使用可能			860	粉体の粒度測定
微量水分計	CA-21	ダイアインストルメンツ	カールフィッシャー電量滴定法			610	溶液中の水分濃度測定
脈波計	APG-1000	ACIMedical	バイアス圧: 6mmHg(1~5mmHg可変) センシングカフ: 27.5cm、30cm、20cm(前腕用)			610	静脈流の定量的評価
有機合成用ドラフトチャンバー	RFG-150SZ	ヤマト科学	有機合成用ドラフトチャンバー			910	有機溶剤使用作業時の保護

<表面処理・環境試験用 (その1)>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
接触角測定装置	FTA-125	FTA	測定範囲: 0~180° 分解能: 0.1° 画面取り込みレート: 60fps	2006		560	材料のぬれ性評価
蛍光X線膜厚計	SFT9400	エスアイアイ・ナノテクノロジー	測定元素: Ti~Bi X線管: 電圧 50kV 電流 1.5mA 測定ソフト: 薄膜 FP 法、検量線法	2007	中丹技術支援室	2,140	金属薄膜の膜厚測定
電磁・渦電流膜厚計 ※3	LZ-200J	ケット科学研究所	測定範囲: 0~1500µm(電磁) 0~800µm(渦電流) 最小測定面積: 3x3mm			200	アルマイト・塗装皮膜等の膜厚測定

※3 乾電池等消耗品は、機器借受者が持参してください。

<表面処理・環境試験用（その2）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
温湿度サイクル試験装置(800L)	PL-4K/P計装	エスベック	温度：-40～+100℃ 湿度：20～98%RH 試験室の大きさ： 1,000(幅)×800(奥行)×1,000(高)mm	2006	中丹技術支援室	960	温度・湿度を固定あるいは可変しての耐環境試験
小型高温チャンバー	ST-120B1	エスベック	温度：(外囲温度+20℃)～+200℃ 試験室寸法：400×350×280 ^H mm			100	高温環境下での耐環境試験
振動試験機(16kN)	F-16000BDH/LA16AW	エミック	方式：電動式 最大加振力： 16.0kN(正弦波) 12.8kN r m s(ランダム波) 40.0kN(ショック波) 最大変位：56mm p-p 最大速度：2.3m/sec 振動数範囲：3～2,000Hz(加振テーブルの種類、積載重量等により変動し、振動範囲は狭くなります) 加振テーブル： 水平加振台(800×800mm、最大3～1,700Hz) 垂直補助テーブル(800×800mm、最大3～300Hz) 垂直補助テーブル(500×500mm、最大3～550Hz) 電子部品用高周波治具(150×150×150mm、最大3～2,000Hz)			2,650	振動試験
騒音計 ※3	NL-22	リオン	測定周波数範囲：20～8,000Hz 測定レベル範囲(A特性)：28～130dB 1/1・1/3実時間オクターブ分析			100	環境騒音・機械騒音の測定
振動レベル計 ※3	VM-53A(ピックアップ：PV-83C)	リオン	測定周波数範囲 振動レベル：1～80Hz 振動加速度レベル：1～80Hz 振動レベル範囲：25～120dB(Lv-Z)			100	地盤振動の測定 (人体の振動感覚特性で補正した振動レベルの計測)

※3 乾電池等消耗品は、機器借受者が持参してください。

<映像・工芸技術用>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
ストロボスコープ	MS-600	菅原研究所	発光周波数範囲 30～60000r/min	2006	中丹技術支援室	100	点滅発光による動作確認
デジタルハイスピードカメラ	MEMORECAMfx K4	ナック	撮像素子画素数 1280×1024 1000コマ/秒 ISO 2400(カラー)			1,420	高速撮影映像による挙動解析

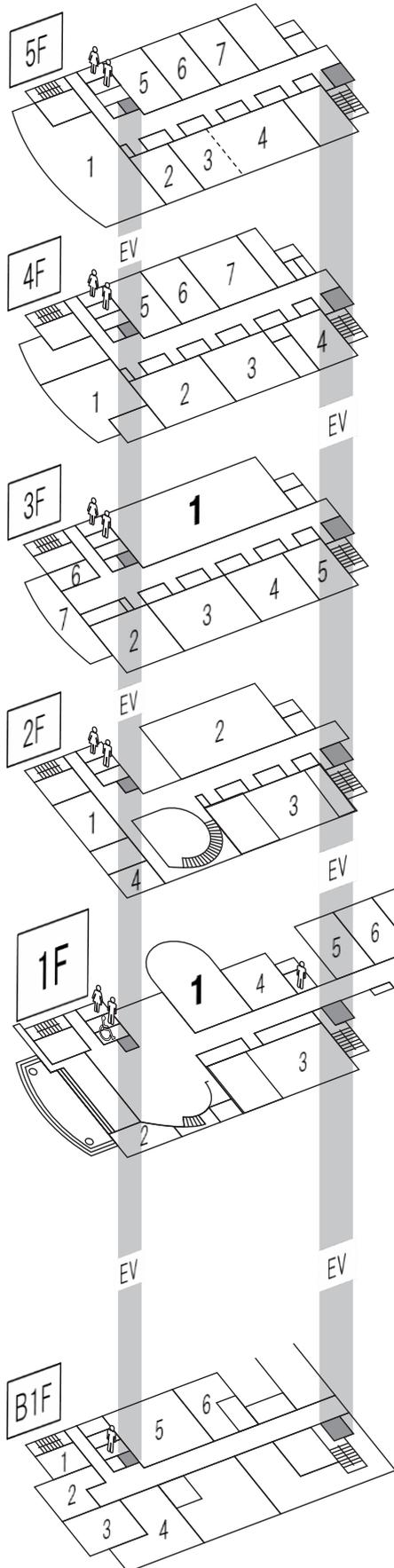
<造形・試作用>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
非接触3次元デジタル計測	VIVID9i	コニカミルタセンシング	測定範囲(最大) 1495×1121×1750mm 出力画素数 640×480	2006	中丹技術支援室	1,630	非接触型の3次元測定
3Dプリンター(ラピッドプロトタイプ)	dimension Elite	Stratasys	造形サイズ(最大)：W203×D203×H305 積層ピッチ：0.178mm	2007		3,060	3次元CADデータからの立体モデルの作成
高速開発支援センター(VDIシミュレーションシステム)	Mechanical EnterpriseCFD EnterpriseHFSS Maxwell 3D ADINA ソリッドワークス	ANSYS 他	構造解析・熱・振動 熱流体・乱流・回転機械 高周波電磁界解析 電磁界解析 各種連成解析	2017		2,550	各種シミュレーション及びモデリングソフト
高速開発支援センター(3次元スキャナー)	ATOS core45, 200, 500	Gom	測定範囲：45×30mm, 200×150mm, 500×380mm 出力画素数：2560×1920 リバース用ソフト：Geomagics Design X 検査用ソフト：Gom Inspect Pro 動的評価：7Hz			2,550	非接触型による測定 (リバースエンジニアリング・CAT)
高速開発支援センター(高精度3Dプリンター)	AGILISTA-3200	キーエンス	造形サイズ(最大)： 297×210×200mm 積層ピッチ：0.015mm 材質：硬質樹脂(アクリル系樹脂)			2,550	3次元CADデータからの立体モデルの作成

館内案内

※ 京都府中小企業技術センターの受付(事務室)は3階にございます。



5F 京都府中小企業技術センター

1	交流サロン	5	セラミックス研究室
2	第4会議室	6	工業材料研究室
3	第1研修室	7	資料室
4	第2研修室		

4F 京都府中小企業技術センター

1	電子・情報技術研究室	5	電子研究室
2	生産環境研究室	6	環境試験室
3	食品・バイオ研究室	7	表面処理研究室
4	デザイン研究室		

3F 京都府中小企業技術センター

1	事務室（総務課・企画連携課 基盤技術課・応用技術課）	4	電子顕微鏡室
2	化学分析室	5	X線分析室
3	機器分析室	6	工芸技術開発室
		7	技術センター 所長室

2F (公財)京都産業21、(一社)京都発明協会 ほか

1	(一社)京都発明協会	3	(一社)京都スマートシティ推進協議会
2	(公財)京都産業21	4	京都産業21 専務理事室

1F 京都府中小企業技術センター、(公財)京都産業21

1	総合受付・お客様相談室	8	企業連携技術開発室
2	第1会議室	9	電子技術開発室(電波暗室)
3	(公財)京都産業21	10	金属加工技術開発室
4	特別参与室・理事長室	11	機械加工技術開発室
5	食品・微生物技術開発室	12	非破壊検査室
6	生産環境技術開発室	13	材料試験室
7	表面加工技術開発室	14	電子・材料試験室

B1F 京都府中小企業技術センター

1	試料作成室	4	材料物性研究室
2	光技術開発室	5	精密測定室
3	電磁波シールドルーム	6	機械加工研究室

沿革

昭和21年4月	下京区西七条名倉町に京都府立機械工業指導所が開設され、旧京都府立機械工養成所の全職員と全施設がこれに引き継がれた。
昭和25年8月	京都府立産業能率研究所の設立
昭和37年8月	産業能率研究所と機械工業指導所を統合し、京都府立中小企業指導所を設置（それぞれ経営指導部、技術指導部となる）
昭和41年6月	名称を京都府立中小企業総合指導所に変更
平成元年10月	京都リサーチパーク内に移転。名称を京都府中小企業総合センターに変更
平成13年4月	組織変更（経営・技術各部門を機能別に再編、けいはんな分室設置）
平成17年4月	組織変更（経営部門を(財)京都産業21に移管し、名称を京都府中小企業技術センターに変更）
平成19年4月	組織変更（北部産業技術支援センター・綾部に中丹技術支援室を設置）
平成20年4月	組織変更（部制を廃止し、4課2室に変更）
平成24年8月	京都府中小企業技術センター創立50周年記念事業開催
平成27年4月	けいはんな分室を「けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）」に移転
平成30年4月	中丹技術支援室を「北部産業創造センター」に移転

当センター名のロゴタイプについて

「信頼感」や「力強さ」を感じさせるゴシック体を基本にしつつ、柔らかくアレンジすることで「柔軟かつ効果的なサービスの提供」を、さらに「京」の一部を特徴的に丸くすることでリズム感を出し、「迅速な対応」を表現するとともに「お客様へのほほえみ」をあらわしています。

令和4年度 事業概要報告書

令和5年7月

京都府中小企業技術センター

〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 134
(七本松通五条下ル)

TEL 075-315-2811

FAX 075-315-9497

京都府産業支援センター ご案内

URL : <http://kyoto-isc.jp/> ◇総合相談窓口◇ TEL : 075-315-8660

■ 技術のことなら URL : <https://www.kptc.jp/>

京都府中小企業技術センター

<本所>

〒600-8813
京都市下京区中堂寺南町134
(七本松通五条下ル 京都リサーチパーク内)

◇ 総務課

TEL:075-315-2811 FAX:075-315-9497

◇ 企画連携課

TEL:075-315-8635 FAX: //

◇ 基盤技術課

TEL:075-315-8633 FAX: //

◇ 応用技術課

TEL:075-315-8634 FAX: //

<中丹技術支援室>

〒623-0011
京都府綾部市青野町西馬場下33-1
北部産業創造センター内
TEL:0773-43-4340 FAX:0773-43-4341

<けいはんな分室>

〒619-0294
関西文化学術研究都市(京都府精華・西木津地区)
木津川市木津川台9丁目6/相楽郡精華町精華台7丁目5
けいはんなオープンイノベーションセンター(KICK)内
TEL:0774-95-5050 FAX:0774-66-7546

■ 経営・創業・マーケティングのことなら URL : <https://www.ki21.jp/>

公益財団法人 京都産業21

TEL : 075-315-9234

■ 知的財産のことなら URL : <http://kyoto-hatsumei.com/>

京都府知的財産総合サポートセンター

TEL : 075-315-8686

ACCESS

◆ JRをご利用の場合

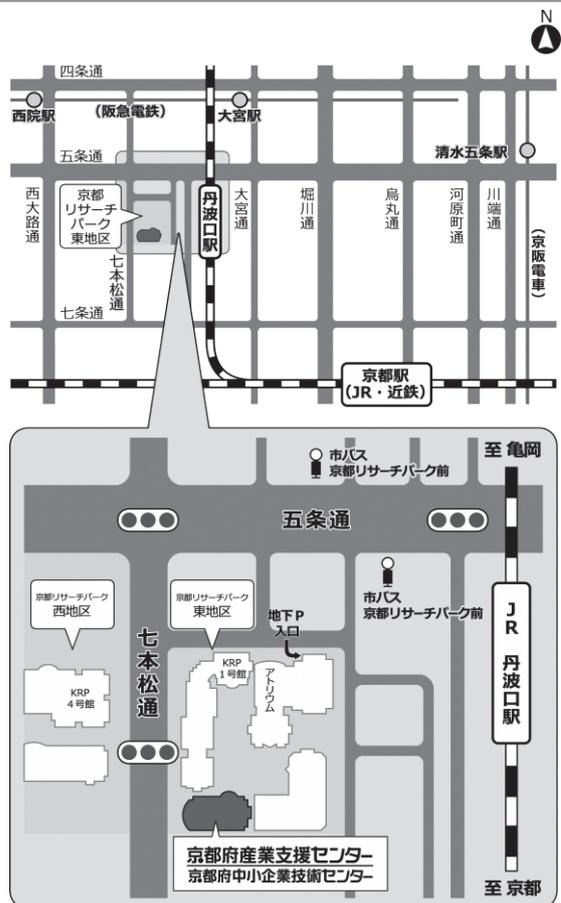
- 丹波口駅から西へ徒歩5分

◆ 市バスをご利用の場合

- 阪急大宮駅から32系統「京都外大前」行き
- 阪急西院駅から75系統「京都駅」行き
- 京阪清水五条駅から80系統「西京極・太秦天神川駅」行き
(河原町五条バス停 乗車)
上記の市バスで「京都リサーチパーク前」下車
七本松通を南へ200m 東側

◆ 地下駐車場

- 入庫後15分無料
- 昼間(08:00~20:00) 100円/15分
- 夜間(20:00~08:00) 100円/60分
- 平日 当日最大 1,800円
- 土日祝 当日最大 1,300円





京都府中小企業技術センター